

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Nexchip 晶合集成

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

中期業績公告 截至2026年6月30日止六個月

主要會計數據和財務指標

單位：人民幣千元

	本報告期 (未經審計)	上年同期 (未經審計)	本報告期 比上年 同期增減 變動比例
收入及利潤			
收入	5,765,812	5,129,794	12.40%
除所得稅前利潤	235,601	232,047	1.53%
期內利潤	221,521	232,000	-4.52%
本公司擁有人應佔期內利潤	245,373	332,129	-26.12%
經營活動產生的現金流量淨額	2,797,992	1,705,036	64.10%
本公司擁有人應佔利潤的每股基本 收益(人民幣元/股)	0.13	0.17	-23.53%
本公司擁有人應佔利潤的每股稀釋 收益(人民幣元/股)	0.13	0.17	-23.53%
資產及負債	本報告期末 (未經審計)	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動比例
非流動資產	48,632,033	45,753,244	6.29%
流動資產	10,150,570	7,544,725	34.54%
流動負債	5,116,479	5,261,431	-2.75%
流動資產淨額	5,034,091	2,283,294	120.47%
總資產減流動負債	53,666,124	48,036,538	11.72%
非流動負債	22,539,833	19,948,849	12.99%
資產淨額	31,126,291	28,087,689	10.82%
本公司擁有人應佔權益	23,289,781	21,768,532	6.99%
非控股權益	7,836,510	6,319,157	24.01%
資產負債率(%)	47.05	47.30	減少 0.25個百分點

合肥晶合集成電路股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2026年6月30日止六個月(「報告期」)之未經審核中期業績，連同截至2025年6月30日止六個月的未經審核數據作比較之用。除另有界定外，本公告所用詞彙應與本公司所刊發日期為2026年6月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

展望

按國際財務報告準則，本集團預計2026年第三季度的指引為(未經審計):我們預計2026年第三季度的收入約在人民幣3,200,000千元至3,300,000千元之間；我們預計2026年第三季度的毛利率約在25%至27%之間。

上述指引乃管理層基於截至本公告日期的現有訂單、客戶需求、產能利用情況及其他目前可得的經營資料作出的業務預期，僅旨在說明本集團目前的業務趨勢，並不構成《香港上市規則》項下的盈利預測，亦不構成對公司的任何投資建議，敬請投資者注意投資風險。

展望2026年下半年，AI產業發展為國內集成電路製造行業帶來新的機遇：一方面AI技術的發展催生了新的應用領域，市場規模擴張；另一方面，海外供給端產能被AI產品擠壓，其他品類製造訂單外溢。本集團當前訂單充足，產能利用率持續保持高位。後續我們將緊跟客戶需求，加快技術與產品迭代，為客戶提供穩定的產能供給、全面的技術支持和可靠的產品交付，不斷提升我們的盈利水平。

簡明合併全面收益表

	附註	截至6月30日止六個月	
		2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
收入	4	5,765,812	5,129,794
銷售成本	7	(4,532,968)	(3,869,945)
毛利		1,232,844	1,259,849
其他收入	5	144,184	85,697
其他收益及(虧損)淨額	6	103,470	(29,734)
研發開支	7	(609,227)	(694,820)
一般及行政開支	7	(260,237)	(206,235)
銷售開支	7	(44,088)	(28,172)
就金融資產確認減值損失淨額		(260)	(138)
融資成本	8	(306,919)	(150,833)
分佔聯營企業業績淨額		(24,166)	(3,567)
除所得稅前利潤		235,601	232,047
所得稅費用	9	(14,080)	(47)
期內利潤		221,521	232,000
以下人士應佔期內利潤／(虧損)：			
本公司擁有人		245,373	332,129
非控股權益		(23,852)	(100,129)
		221,521	232,000
期內其他全面(虧損)／收益，扣除稅項			
隨後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務財務報表的匯兌差額，			
扣除稅項		(14,547)	342
隨後不會重新分類至損益的項目：			
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益			
的金融資產公允價值變動，扣除稅項		1,149,688	10,205
期內全面收益總額		1,356,662	242,547

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
附註	(未經審計)	(未經審計)

以下人士應佔期內全面收益／(虧損)總額：

本公司擁有人	1,380,514	342,676
非控股權益	(23,852)	(100,129)

	<u>1,356,662</u>	<u>242,547</u>
--	------------------	----------------

本公司擁有人應佔利潤的每股收益
(「每股收益」)

10

基本(每股人民幣元)	<u>0.13</u>	<u>0.17</u>
------------	-------------	-------------

稀釋(每股人民幣元)	<u>0.13</u>	<u>0.17</u>
------------	-------------	-------------

上述中期簡明合併全面收益表應與隨附附註一併閱讀。

簡明合併財務狀況表

		於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
	附註		
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	44,246,941	42,375,241
使用權資產		99,630	98,843
無形資產	12	1,314,867	1,223,955
投資聯營企業		525,561	549,728
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	14	31,730	43,662
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	15	1,555,507	501,964
預付款項、其他應收款及其他資產	18	857,797	959,851
		48,632,033	45,753,244
流動資產			
存貨	16	1,590,023	1,714,857
貿易應收款項	17	1,239,611	1,187,472
預付款項、其他應收款及其他資產	18	665,436	636,741
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	14	1,866,233	1,722,972
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	15	—	6,063
限制性銀行存款	19	108,569	—
現金及現金等價物		4,680,698	2,276,620
		10,150,570	7,544,725
流動負債			
貿易及其他應付款項	20	2,803,560	2,955,582
合同負債	21	211,874	316,652
借款	22	2,070,397	1,972,941
應付債券		30,408	16,256
應付所得稅		240	—
		5,116,479	5,261,431
流動資產淨值		5,034,091	2,283,294
總資產減流動負債		53,666,124	48,036,538

		於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
	附註		
非流動負債			
貿易及其他應付款項	20	1,558	1,476
借款	22	19,775,911	17,519,740
應付債券		2,000,000	2,000,000
遞延收入	23	749,698	427,633
遞延稅項負債		12,666	—
		<u>22,539,833</u>	<u>19,948,849</u>
資產淨值		<u>31,126,291</u>	<u>28,087,689</u>
權益			
股本	24	2,007,592	2,007,592
庫存股	24	(891,776)	(891,776)
其他儲備		20,403,999	19,210,449
留存收益		<u>1,769,966</u>	<u>1,442,267</u>
本公司擁有人應佔權益		23,289,781	21,768,532
非控股權益		<u>7,836,510</u>	<u>6,319,157</u>
權益總額		<u>31,126,291</u>	<u>28,087,689</u>

上述中期簡明合併財務狀況表應與隨附附註一併閱讀。

簡明合併權益變動表

	本公司擁有人應佔										非控股 權益 權益總額	
	股本	庫存股	股份溢價	其他	股份	其他全面	法定公積	留存收益	小計			
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元
	附註24	附註24										
於2026年												
1月1日	2,007,592	(891,776)	19,268,407	(669,776)	90,848	303,290	217,680	1,442,267	21,768,532	6,319,157	28,087,689	
期內利潤／ (虧損)	-	-	-	-	-	-	-	245,373	245,373	(23,852)	221,521	
期內其他全面收益：												
以公允價值計量且 其變動計入其他綜合 收益的金融資產公允 價值變動，扣除稅項	-	-	-	-	-	1,149,688	-	-	1,149,688	-	1,149,688	
換算海外業務財務報表 的匯兌差額，扣除稅項	-	-	-	-	-	(14,547)	-	-	(14,547)	-	(14,547)	
期內全面收益／(虧損) 總額	-	-	-	-	-	1,135,141	-	245,373	1,380,514	(23,852)	1,356,662	
股份支付開支(附註25)	-	-	-	-	81,940	-	-	-	81,940	-	81,940	
一名非控股股東注資	-	-	-	58,795	-	-	-	-	58,795	1,541,205	1,600,000	
出售以公允價值計量且 其變動計入其他綜合 收益的金融資產	-	-	-	-	-	(91,473)	9,147	82,326	-	-	-	
於2026年6月30日 (未經審計)	2,007,592	(891,776)	19,268,407	(610,981)	172,788	1,346,958	226,827	1,769,966	23,289,781	7,836,510	31,126,291	

本公司擁有人應佔

	股本 人民幣 千元 附註24	庫存股 儲備 人民幣 千元 附註24	股份溢價 人民幣 千元	其他 資本儲備 人民幣 千元	股份 支付儲備 人民幣 千元	其他全面 收益儲備 人民幣 千元	法定公積 人民幣 千元	留存收益 人民幣 千元	小計 人民幣 千元	非控股 權益 人民幣 千元	權益總額 人民幣 千元
於2025年 1月1日	2,006,135	(891,776)	19,246,097	(731,569)	28,300	62,977	135,942	1,014,206	20,870,312	5,218,656	26,088,968
期內利潤/ (虧損)	-	-	-	-	-	-	-	332,129	332,129	(100,129)	232,000
期內其他全面收益： 以公允價值計量且其 變動計入其他綜合 收益的金融資產公允 價值變動，扣除稅項	-	-	-	-	-	10,205	-	-	10,205	-	10,205
換算海外業務財務報表 的匯兌差額，扣除稅項	-	-	-	-	-	342	-	-	342	-	342
期內全面收益/(虧損) 總額	-	-	-	-	-	10,547	-	332,129	342,676	(100,129)	242,547
股份支付開支(附註25)	-	-	-	-	6,198	-	-	-	6,198	-	6,198
已宣派股利 (附註13)	-	-	-	-	-	-	-	(194,405)	(194,405)	-	(194,405)
於2025年6月30日 (未經審計)	2,006,135	(891,776)	19,246,097	(731,569)	34,498	73,524	135,942	1,151,930	21,024,781	5,118,527	26,143,308

附註：

- (a) 其他全面收益儲備指由於換算海外業務財務報表及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動產生的儲備。
- (b) 根據《中國公司法》，在中國註冊的公司須將法定除稅後利潤的10%分配至法定公積，直至儲備的累計總額達到公司註冊資本的50%。經中國有關機關批准，法定公積可用於抵銷任何累計虧損或增加公司的註冊資本。法定公積不可用於向中國公司的股權持有人進行股利分派。

上述中期簡明合併權益變動表應與隨附附註一併閱讀。

簡明合併現金流量表

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
經營活動		
除所得稅前利潤	235,601	232,047
就以下各項作出調整：		
應佔聯營企業業績淨額	24,166	3,567
物業、廠房及設備折舊	2,078,870	1,802,901
使用權資產折舊	1,282	2,398
無形資產攤銷	180,151	186,053
結構性存款、可轉讓大額存單、收益憑證、 其他以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產以及以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產的投資收入	(39,332)	(17,142)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產公允價值收益	(46,924)	(9,978)
就存貨(轉回)/確認減值損失淨額	(66,590)	37,116
財務費用	306,919	250,833
就金融資產確認減值損失淨額	260	138
股份支付開支	74,691	6,198
遞延政府補助攤銷	(83,534)	(39,161)
匯兌(收益)/虧損淨額	(15,365)	56,955
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產的收益淨額	(1,659)	—
貿易應收款項(增加)/減少	(106,278)	36,308
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產減少/(增加)	6,063	(2,456)
預付款項、其他應收款及其他資產減少/(增加)	36,513	(63,000)
存貨減少/(增加)	191,425	(179,342)
貿易及其他應付款項增加/(減少)	126,595	(237,825)
合同負債減少	(104,779)	(360,402)
經營產生的現金	2,798,075	1,705,208
已付所得稅	(83)	(172)
經營活動產生的現金流量淨額	2,797,992	1,705,036

截至6月30日止六個月
2026年 2025年
人民幣千元 人民幣千元
(未經審計) (未經審計)

投資活動

購買物業、廠房及設備	(3,667,604)	(3,968,516)
購買無形資產	(296,635)	(133,364)
使用權資產預付款項	—	(40,200)
收取限制性銀行存款到期款項	—	863
已收利息	42,274	17,704
投資聯營企業	—	(100,000)
出售固定收益憑證所得款項	—	100,000
購買固定收益憑證	—	(250,000)
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所得款項	2,369,197	1,910,000
購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	(2,468,183)	(2,306,569)
購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	(41,721)	(30,000)
出售以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產所得款項	143,360	—

投資活動所用現金流量淨額

(3,919,312)	(4,800,082)
-------------	-------------

籌資活動

一家附屬公司非控股股東注資	1,600,000	—
借款所得款項	3,218,703	2,189,000
發行應付債券所得款項	—	199,920
支付限制性銀行存款	(108,703)	—
償還借款	(864,835)	(1,540,507)
已付借款及應付債券利息	(292,874)	(281,754)
已付股利	—	(194,502)
支付上市開支	(3,929)	(11)
租賃本金部分及利息部分付款	—	(768)

籌資活動產生的現金流量淨額

3,548,362	371,378
-----------	---------

現金及現金等價物增加／(減少)淨額	2,427,042	(2,723,668)
期初現金及現金等價物	2,276,620	5,826,895
匯率變動影響淨額	(22,964)	728

期末現金及現金等價物

4,680,698	3,103,955
-----------	-----------

上述中期簡明合併現金流量表應與隨附附註一併閱讀。

中期財務資料附註

1. 一般資料

合肥晶合集成電路股份有限公司(「本公司」)於2015年5月在中國註冊成立為有限責任公司，並於2020年11月25日變更為股份有限公司。本公司的A股已自2023年5月5日起在上海證券交易所上市，而本公司的H股已於2026年7月10日在香港聯合交易所有限公司主板上市。本公司的註冊地址及其主要營業地點位於中國安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事集成電路相關產品及配套產品的研發、生產及銷售。

合肥市建設投資控股(集團)有限公司為本公司控股股東。於2026年6月30日，合肥市建設投資控股(集團)有限公司直接持有及間接持有本公司股權的23.34%及16.37%，合計持有本公司的39.71%股權。本公司的最終擁有人為合肥市人民政府國有資產監督管理委員會。

中期財務資料以人民幣(「人民幣」)呈列，除另有註明者外，所有數值均約整至最接近千位數(人民幣千元)。

本簡明合併財務報表已於2026年8月24日獲董事會批准並刊發。

2. 呈列及編製基準

本集團截至2026年6月30日止六個月的中期財務資料已根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒布的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。

中期財務資料載有合併財務報表及選定解釋附註。所載選定附註旨在闡明於2025年12月31日及截至該日止年度的最新年度合併財務報表以來對理解本集團財務狀況及表現變動屬重大的事件及交易。中期財務資料並無載列根據國際會計準則理事會頒布的國際財務報告準則(「國際財務報告準則會計準則」)編製整套財務報表所需的全部資料及披露。因此，該等未經審計中期財務資料應與本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度的過往財務資料(「過往財務資料」)一併閱讀，該等過往財務資料載於本公司日期為2026年6月30日的招股章程(「招股章程」)附錄一內的會計師報告。

中期財務報告所載有關截至2025年12月31日止年度的財務資料為比較資料，並不構成本公司於該財政年度的法定年度合併財務報表，惟有關財務資料來自招股章程附錄一所披露的會計師報告。

3. 重大會計政策

3.1 國際財務報告準則會計準則的應用

(a) 本集團採納的新訂準則及詮釋

於本中期期間，本集團已就編製本集團中期簡明合併財務資料首次應用國際會計準則理事會頒布的以下國際財務報告準則會計準則修訂本，該等修訂本均於本集團於2026年1月1日開始的年度期間強制生效：

國際財務報告準則第7號及 國際財務報告準則第9號修訂本 國際財務報告準則會計準則的 年度改進	依賴自然能源生產電力的合同 國際財務報告準則會計準則的 年度改進—第11冊
---	---

(b) 已頒布惟本集團尚未應用的國際財務報告準則會計準則的影響

本集團並無提早採納下列已頒布但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則會計準則：

國際財務報告準則第10號及國際會計 準則第28號修訂本	投資者與其聯營企業或合營企業之間 的資產出售或注資 ³
國際財務報告準則第7號、國際財務 報告準則第18號、國際會計準則第1 號、國際會計準則第8號、國際會計 準則第36號及國際會計準則第37號 實例說明修訂本	財務報表中不確定性的披露 ¹
國際財務報告準則第18號	財務報表的呈列及披露 ¹
國際財務報告準則第19號及其修訂本	非公共受託責任附屬公司：披露 ¹
國際財務報告準則第20號	監管資產及監管負債 ²
國際會計準則第28號修訂本	對聯營企業及合營企業投資的公允價 值選擇權 ¹
國際會計準則第21號修訂本	換算為惡性通貨膨脹呈列貨幣 ¹

¹ 於2027年1月1日或之後開始的會計期間生效

² 於2029年1月1日或之後開始的會計期間生效

³ 尚未釐定生效日期

於本中期期間應用國際財務報告準則會計準則修訂本，對本集團於本期及過往期間的財務狀況及表現及／或中期財務資料所載的披露並無重大影響。

除應用國際財務報告準則會計準則修訂本產生的其他會計政策外，中期財務資料所採用的會計政策與編製過往財務資料所遵循者相同。

3.2 關鍵會計估計及判斷

編製符合國際會計準則第34號的中期財務資料需要管理層作出影響政策應用及年初至今的資產與負債、收入及開支呈報金額的判斷、估計及假設。實際結果可能與該等估計有所不同。

於編製中期財務資料時，管理層於應用本集團的會計政策時所作出的重大判斷及估計不確定性的主要來源與過往財務資料所應用者相同。

4. 收入及分部資料

本集團的主要業務於中期財務資料附註1披露。本集團於某一時間點轉移貨品產生的收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
所售貨品類型		
—集成電路晶圓代工	5,765,812	5,105,041
—其他	—	24,753
	<u>5,765,812</u>	<u>5,129,794</u>

國際財務報告準則第15號範圍內的所有客戶合同收入均於某一時間點確認。

經營分部的呈報方式與向主要運營決策者提供的內部報告一致。本集團管理層基於內部組織架構、管理要求及內部報告系統，將本集團作為單一經營分部檢討其表現。因此，僅呈列實體範圍披露以及本集團整體業績及財務狀況、主要客戶及地區資料。

下表載列於截至2026年及2025年6月30日止六個月分別確認的收入中與結轉合同負債有關的部分：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
計入期初合同負債餘額的已確認收入	<u>143,333</u>	<u>223,324</u>

地區資料

下表載列本集團按貨品交付的客戶地理位置劃分的外部客戶收入的地理位置資料：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
外部客戶收入		
—中國大陸	3,653,755	3,059,823
—中國台灣	1,548,471	1,647,968
—其他國家／地區	563,586	422,003
	<u>5,765,812</u>	<u>5,129,794</u>

本集團非流動資產(不包括金融資產及於聯營企業的投資)主要包括物業、廠房及設備，其地理位置基於該等資產的位置。本集團非流動資產的地理位置如下：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元 (未經審計)
非流動資產(不包括金融資產及於聯營企業的投資)		
—中國大陸	46,518,995	44,657,585
—其他國家／地區	240	305
	<u>46,519,235</u>	<u>44,657,890</u>

有關主要客戶的資料

來自個別佔本集團收入10%以上的客戶的收入如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
客戶A	不適用*	547,870
客戶B	不適用*	567,436
客戶C	1,411,675	1,072,707
	<u>1,411,675</u>	<u>2,188,013</u>

* 該客戶的相應收入並無佔本集團於期內總收入10%以上。

5. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
遞延政府補助攤銷	83,534	39,161
利息收入	12,497	24,307
銷售廢棄材料	12,592	11,321
其他政府補助(附註)	2,947	4,782
租金收入淨額	10,953	—
其他	21,661	6,126
	<u>144,184</u>	<u>85,697</u>

附註：

截至2026年及2025年6月30日止六個月，其他政府補助概無未履行條件或者或有事項。

6. 其他收益及虧損淨額

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的		
金融資產的公允價值收益	46,924	9,978
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的		
金融資產的收益淨額	1,659	—
結構性存款、可轉讓大額存單及收益憑證的投資收入	28,242	17,030
匯兌收益／(虧損)淨額	15,365	(56,955)
其他以公允價值計量且其變動計入當期損益的		
金融資產及以公允價值計量且其變動計入		
其他綜合收益的金融資產的投資收入	11,090	112
其他	190	101
	<u>103,470</u>	<u>(29,734)</u>

7. 按性質劃分的開支

計入銷售成本、研發開支、一般及行政開支以及銷售開支的開支分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
製成品及在製品變動	200,801	(51,269)
生產所耗用的原材料	1,414,833	1,332,480
物業、廠房及設備折舊(附註11)	2,104,656	1,802,901
無形資產攤銷(附註12)	188,931	186,053
使用權資產折舊	1,296	2,398
職工福利開支(不包括股份支付開支)	881,353	800,857
能源及燃料成本	247,070	199,655
就存貨(轉回)／確認的減值損失淨額	(66,590)	37,116
修繕成本	166,310	147,530
所耗用的研究及開發材料	104,623	69,053
研究、測試及開發開支	94,647	109,179
技術授權費	52,230	55,481
專業服務費	34,301	25,894
股份支付開支	81,940	6,198
環保成本	5,921	5,244
審計師薪酬	2,264	2,264
H股上市開支	4,466	—
其他	77,738	68,138
減：資本化為無形資產的開發開支	(150,270)	—
	5,446,520	4,799,172

8. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
借款利息支出	289,067	279,674
減：資本化利息	—	(36,956)
減：財政補貼	—	(100,000)
借款利息支出淨額	289,067	142,718
應付債券利息支出	17,852	8,115
	306,919	150,833

附註：截至2025年6月30日止六個月，利息資本化率為每年1.8%，指為在建資產提供資金的貸款的實際融資成本。

9. 所得稅費用

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
即期所得稅	1,398	47
遞延所得稅	12,682	—
所得稅費用	14,080	47

應稅利潤的稅項按相關實體經營所在司法權區的現行稅率計算。

(a) 中國企業所得稅(「企業所得稅」)

根據《中國企業所得稅法》及相關法規，本公司及其附屬公司的企業所得稅根據現行法規、詮釋及慣例按各年內估計應稅利潤按25%的法定稅率計算。

根據中國相關法律及法規及獲稅務主管機關批准，本公司符合資格成為「高新技術企業」，故有權於2020年至2025年期間按15%的優惠稅率繳稅。

根據中國相關法律及法規及獲稅務主管機關批准，本公司及其附屬公司合肥新晶集成電路有限公司有權從其產生應稅利潤的第一年起5年獲豁免繳納企業所得稅，及隨後5年內享受企業所得稅稅率減免50%的優惠。本公司及合肥新晶集成電路有限公司2022年開始產生應稅利潤，2022年1月1日至2026年12月31日免徵企業所得稅，2027年1月1日至2031年12月31日將享受減免50%的企業所得稅。

(b) 於其他司法權區的企業所得稅

其他海外附屬公司的稅項按相關國家現行適當稅率徵收。

10. 本公司擁有人應佔每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益按截至2026年及2025年6月30日止六個月本公司擁有人應佔利潤除以已發行普通股加權平均數計算，當中不包括為股份計劃持有的庫存股，原因為就計算每股收益而言，該等股份不被視為發行在外股份。

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
用於計算基本每股收益的本公司擁有人應佔利潤(人民幣千元)	245,373	332,129
已發行普通股加權平均數(千股)	1,945,503	1,944,047
基本每股收益(每股人民幣元)	0.13	0.17

(b) 稀釋每股收益

截至2026年及2025年6月30日止六個月，本公司授出的股份計劃對每股收益產生潛在稀釋效應。稀釋每股收益基於假設股份計劃產生的所有潛在稀釋普通股獲轉換，並通過調整發行在外普通股加權平均股數計算(共同構成計算稀釋每股收益的分母)。

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
用於計算稀釋每股收益的本公司擁有人應佔利潤 (人民幣千元)	<u>245,373</u>	<u>332,129</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	1,945,503	1,944,047
就股份計劃產生的潛在稀釋普通股調整(千股)	<u>10,973</u>	<u>168</u>
用於計算稀釋每股收益的普通股 加權平均數(千股)	<u>1,956,476</u>	<u>1,944,215</u>
稀釋每股收益(每股人民幣元)	<u>0.13</u>	<u>0.17</u>

11. 物業、廠房及設備

	廠房建築物 人民幣千元	機器設備 人民幣千元	運輸設備 人民幣千元	電子設備 及其他 人民幣千元	動力與 基礎設施 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2026年1月1日							
成本	2,374,274	36,379,542	3,292	637,212	6,206,682	11,720,239	57,321,241
累計折舊	(121,593)	(14,177,863)	(2,826)	(385,601)	(258,117)	–	(14,946,000)
賬面淨值	<u>2,252,681</u>	<u>22,201,679</u>	<u>466</u>	<u>251,611</u>	<u>5,948,565</u>	<u>11,720,239</u>	<u>42,375,241</u>
截至2026年6月30日止六個月 (未經審計)							
期初賬面淨值	2,252,681	22,201,679	466	251,611	5,948,565	11,720,239	42,375,241
添置	–	–	–	–	–	3,976,376	3,976,376
折舊(附註(a))	(42,081)	(1,861,172)	(70)	(69,378)	(131,955)	–	(2,104,656)
轉固	532	1,555,638	–	81,321	11,127	(1,648,618)	–
匯兌調整	–	–	–	(20)	–	–	(20)
期末賬面淨值	<u>2,211,132</u>	<u>21,896,145</u>	<u>396</u>	<u>263,534</u>	<u>5,827,737</u>	<u>14,047,997</u>	<u>44,246,941</u>
於2026年6月30日(未經審計)							
成本	2,374,806	37,935,180	2,710	717,230	6,217,809	14,047,997	61,295,732
累計折舊	(163,674)	(16,039,035)	(2,314)	(453,696)	(390,072)	–	(17,048,791)
賬面淨值	<u>2,211,132</u>	<u>21,896,145</u>	<u>396</u>	<u>263,534</u>	<u>5,827,737</u>	<u>14,047,997</u>	<u>44,246,941</u>
於2025年1月1日							
成本	2,382,031	31,010,675	2,733	520,000	2,070,331	13,221,865	49,207,635
累計折舊	(37,677)	(10,744,780)	(2,733)	(264,914)	(143,494)	–	(11,193,598)
賬面淨值	<u>2,344,354</u>	<u>20,265,895</u>	<u>–</u>	<u>255,086</u>	<u>1,926,837</u>	<u>13,221,865</u>	<u>38,014,037</u>
截至2025年6月30日止六個月 (未經審計)							
期初賬面淨值	2,344,354	20,265,895	–	255,086	1,926,837	13,221,865	38,014,037
添置	–	–	–	139	–	3,880,728	3,880,867
成本調整	(32,837)	–	–	–	–	–	(32,837)
折舊(附註(a))	(41,841)	(1,653,650)	(23)	(58,269)	(49,118)	–	(1,802,901)
轉固	25,079	3,217,937	559	56,232	459,399	(3,759,206)	–
匯兌調整	–	–	–	12	–	–	12
期末賬面淨值	<u>2,294,755</u>	<u>21,830,182</u>	<u>536</u>	<u>253,200</u>	<u>2,337,118</u>	<u>13,343,387</u>	<u>40,059,178</u>
於2025年6月30日(未經審計)							
成本	2,374,273	34,228,612	3,292	575,346	2,529,730	13,343,387	53,054,640
累計折舊	(79,518)	(12,398,430)	(2,756)	(322,146)	(192,612)	–	(12,995,462)
賬面淨值	<u>2,294,755</u>	<u>21,830,182</u>	<u>536</u>	<u>253,200</u>	<u>2,337,118</u>	<u>13,343,387</u>	<u>40,059,178</u>

附註：

(a) 本集團物業、廠房及設備的折舊已按以下方式確認：

截至2026年6月30日止六個月，於銷售成本、研發開支、一般及行政開支以及銷售開支確認的物業、廠房及設備折舊分別約為人民幣1,983,569,000元、人民幣67,551,000元、人民幣53,462,000元及人民幣74,000元。

截至2025年6月30日止六個月，於銷售成本、研發開支、一般及行政開支以及銷售開支確認的物業、廠房及設備折舊分別約為人民幣1,689,434,000元、人民幣70,357,000元、人民幣42,987,000元及人民幣123,000元。

(b) 本集團已抵押下列賬面值的若干物業、廠房及設備，為本集團獲授的借款作抵押。本集團為借款所抵押物業、廠房及設備的詳情披露如下：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
機器設備	<u>3,995,232</u>	<u>4,112,850</u>

12. 無形資產

	專利權及 非專利技術 人民幣千元	軟件及其他 人民幣千元	開發開支 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2026年1月1日				
成本	2,215,409	1,166,747	—	3,382,156
累計攤銷	(1,262,802)	(599,660)	—	(1,862,462)
累計減值	<u>(295,739)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(295,739)</u>
賬面淨值	<u>656,868</u>	<u>567,087</u>	<u>—</u>	<u>1,223,955</u>
截至2026年6月30日止六個月 (未經審計)				
期初賬面淨值	656,868	567,087	—	1,223,955
添置	—	129,573	150,270	279,843
攤銷(附註)	<u>(76,346)</u>	<u>(112,585)</u>	<u>—</u>	<u>(188,931)</u>
期末賬面淨值	<u>580,522</u>	<u>584,075</u>	<u>150,270</u>	<u>1,314,867</u>

	專利權及 非專利技術 人民幣千元	軟件及其他 人民幣千元	開發開支 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2026年6月30日(未經審計)				
成本	2,215,409	1,296,320	150,270	3,661,999
累計攤銷	(1,339,148)	(712,245)	–	(2,051,393)
累計減值	(295,739)	–	–	(295,739)
賬面淨值	<u>580,522</u>	<u>584,075</u>	<u>150,270</u>	<u>1,314,867</u>
於2025年1月1日				
成本	2,215,409	807,945	–	3,023,354
累計攤銷	(1,110,110)	(376,542)	–	(1,486,652)
累計減值	(295,739)	–	–	(295,739)
賬面淨值	<u>809,560</u>	<u>431,403</u>	<u>–</u>	<u>1,240,963</u>
截至2025年6月30日止六個月 (未經審計)				
期初賬面淨值	809,560	431,403	–	1,240,963
添置	–	216,112	–	216,112
攤銷(附註)	(76,346)	(109,707)	–	(186,053)
期末賬面淨值	<u>733,214</u>	<u>537,808</u>	<u>–</u>	<u>1,271,022</u>
於2025年6月30日(未經審計)				
成本	2,215,409	1,024,057	–	3,239,466
累計攤銷	(1,186,456)	(486,249)	–	(1,672,705)
累計減值	(295,739)	–	–	(295,739)
賬面淨值	<u>733,214</u>	<u>537,808</u>	<u>–</u>	<u>1,271,022</u>

附註：

本集團無形資產攤銷已按以下方式確認：

截至2026年6月30日止六個月，於銷售成本、研發開支以及一般及行政開支確認的無形資產攤銷分別約為人民幣88,093,000元、人民幣94,016,000元及人民幣6,822,000元。

截至2025年6月30日止六個月，於銷售成本、研發開支以及一般及行政開支確認的無形資產攤銷分別約為人民幣81,455,000元、人民幣100,008,000元及人民幣4,590,000元。

13. 股利

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
末期股利	<u>-</u>	<u>194,405</u>

截至2026年6月30日止六個月概無宣派股利。

截至2024年12月31日止年度的末期股利每10股人民幣1.00元(含稅)，合計約人民幣194,404,665.70元，已於2025年5月28日在本公司的2024年年度股東會上獲批准。於2024年12月31日，本集團並無將有關股利確認為負債，惟於截至2025年6月30日止六個月列賬為留存收益撥款。該末期股利已於2025年6月19日派付。

14. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
非即期		
—可轉讓大額存單	30,030	41,962
—非上市權益工具	<u>1,700</u>	<u>1,700</u>
	<u>31,730</u>	<u>43,662</u>
即期		
—結構性存款	701,046	500,285
—可轉讓大額存單	569,053	833,109
—收益憑證	-	100,080
—上市權益工具		
奇瑞汽車股份有限公司(附註(b))	197,613	289,498
華勤技術股份有限公司(附註(a))	209,574	-
聖邦微電子(北京)股份有限公司	67,862	-
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(附註(a))	111,986	-
—其他	<u>9,099</u>	<u>-</u>
	<u>1,866,233</u>	<u>1,722,972</u>

附註：

(a) 於2026年6月30日，對華勤技術股份有限公司及合肥芯碁微電子裝備股份有限公司的股權投資限制流通。

(b) 於2025年12月31日，對奇瑞汽車股份有限公司的股權投資限制流通。

15. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
非即期		
—上市權益工具		
思特威(上海)電子科技股份有限公司	80,324	71,335
上海新相微電子股份有限公司	—	83,741
北京屹唐半導體科技股份有限公司(附註)	152,663	86,911
西安奕斯偉材料科技股份有限公司(附註)	676,376	259,977
重慶臻寶科技股份有限公司(附註)	646,144	—
	<u>1,555,507</u>	<u>501,964</u>
即期		
—以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 應收票據	<u>—</u>	<u>6,063</u>

附註：

於2026年6月30日，對北京屹唐半導體科技股份有限公司、西安奕斯偉材料科技股份有限公司及重慶臻寶科技股份有限公司的股權投資因戰略分配而限制流通。

於2025年12月31日，對北京屹唐半導體科技股份有限公司及西安奕斯偉材料科技股份有限公司的股權投資因戰略分配而限制流通。

16. 存貨

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
原材料	794,068	784,692
在製品	779,421	686,637
製成品	55,657	349,242
	<u>1,629,146</u>	<u>1,820,571</u>
減：減值準備	(39,123)	(105,714)
	<u>1,590,023</u>	<u>1,714,857</u>

17. 貿易應收款項

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
貿易應收款項	1,239,924	1,187,560
減：減值準備	(313)	(88)
	<u>1,239,611</u>	<u>1,187,472</u>

截至2026年6月30日止六個月及截至2025年12月31日止年度，授予客戶的信用期一般介乎35至80天。

基於確認日期的貿易應收款項賬齡分析如下：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
1年內	1,239,836	1,187,472
2年以上但3年內	—	88
3年以上	88	—
	<u>1,239,924</u>	<u>1,187,560</u>

18. 預付款項、其他應收款及其他資產

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
非流動		
預付長期資產購置款	649,522	692,587
1年後到期的產能保證預付款項	23,903	72,883
其他非流動資產	180,036	191,902
其他	4,336	2,479
	<u>857,797</u>	<u>959,851</u>
流動		
其他應收款	27,794	30,120
減：減值準備	(1,788)	(1,753)
	<u>26,006</u>	<u>28,367</u>
待抵扣增值稅進項稅額	474,583	460,123
1年內到期的產能保證預付款項	63,610	63,610
材料及其他預付款項	68,602	61,141
遞延上市開支	32,528	23,422
其他	107	78
	<u>665,436</u>	<u>636,741</u>

19. 限制性銀行存款

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
銀行借款的存款押記	<u>108,569</u>	<u>—</u>

20. 貿易及其他應付款項

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
非即期		
應付薪資及福利	<u>1,558</u>	<u>1,476</u>
即期		
貿易應付款項	886,493	805,536
採購非流動資產的應付款項	1,094,171	903,767
應付薪資及福利	182,121	154,864
已收按金	553,396	953,440
其他應付稅項	31,293	93,114
其他	<u>56,086</u>	<u>44,861</u>
	<u>2,803,560</u>	<u>2,955,582</u>

供應商授予的信用期一般為30至90天。於2026年6月30日及2025年12月31日，本集團按確認日期的貿易應付款項賬齡分析如下：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
-1年內	851,348	761,441
-1年以上但於2年內	28,792	38,955
-2年以上但於3年內	5,725	4,953
-3年以上	<u>628</u>	<u>187</u>
	<u>886,493</u>	<u>805,536</u>

21. 合同負債

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
來自客戶的墊款	<u>211,874</u>	<u>316,652</u>

收入於集成電路晶圓代工服務下交付的貨品控制權轉移予客戶且並無可能會影響客戶收取已交付貨品的未履行責任時確認。本集團的合同負債主要包括客戶作出的墊款，該等款項通常用於結算已交付貨品。

22. 借款

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
非流動		
銀行借款的非流動部分—無抵押及無擔保	12,350,800	9,712,040
銀行借款的非流動部分—無抵押但有擔保(附註)	4,425,111	4,807,700
其他借款的非流動部分—無抵押但有擔保(附註)	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
	<u>19,775,911</u>	<u>17,519,740</u>
流動		
短期銀行借款—無抵押及無擔保	470,234	420,190
短期銀行借款—有抵押及無擔保(附註)	108,725	—
長期銀行借款的流動部分—無抵押及無擔保	741,417	825,061
長期銀行借款的流動部分—無抵押但有擔保(附註)	744,953	722,115
長期其他借款的流動部分—無抵押但有擔保(附註)	<u>5,068</u>	<u>5,575</u>
	<u>2,070,397</u>	<u>1,972,941</u>

於2026年6月30日及2025年12月31日，借款的實際年利率介乎1.50%至6.18%。

附註：

於2026年6月30日及2025年12月31日，由本公司提供擔保的附屬公司合肥新品集成電路有限公司銀行借款的未償還餘額分別約為人民幣5,170,064,000元及人民幣5,529,815,000元。

於2026年6月30日及2025年12月31日，其他借款人民幣3,005,068,000元及人民幣3,005,575,000元為來自華泰資產管理有限公司的借款，本集團其他借款的未償還餘額由合肥市建設投資控股(集團)有限公司提供擔保。

於2026年6月30日及2025年12月31日，由合肥市建設投資控股(集團)有限公司提供擔保的其他借款餘額依法歸類為無抵押借款，原因為並無向貸款人提供抵押品。合肥市建設投資控股(集團)有限公司要求提供反擔保，銀行及其他借款以本集團的機器設備向擔保人作質押。本集團為借款而質押的資產詳情於中期財務資料附註27披露。

於2026年6月30日及2025年12月31日，短期銀行借款人民幣108,725,000元及零以銀行存款作為抵押。本集團為借款而質押的資產詳情於中期財務資料附註27披露。

截至2026年6月30日止六個月及截至2025年12月31日止年度，本集團並無違反借款協議項下的任何財務契諾。本集團的應償還借款如下：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
分析為：		
銀行借款：		
-1年內	2,065,329	1,967,366
-1年以上但於2年內	1,763,752	1,540,669
-2年以上但於5年內	7,548,118	6,406,618
-5年以上	7,464,041	6,572,453
	18,841,240	16,487,106
其他借款：		
-1年內	5,068	5,575
-2年以上但於5年內	3,000,000	3,000,000
	3,005,068	3,005,575
	21,846,308	19,492,681

23. 遞延收入

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
政府補助	<u>749,698</u>	<u>427,633</u>

24. 股本及庫存股

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
股本	2,007,592	2,007,592
庫存股儲備	<u>(891,776)</u>	<u>(891,776)</u>

本公司法定、已發行及繳足股本變動如下：

	股份數目 千股	股本 人民幣千元
每股面值人民幣1元的普通股		
於2026年1月1日及2026年6月30日(未經審計)	<u>2,007,592</u>	<u>2,007,592</u>
於2025年1月1日及2025年6月30日(未經審計)	<u>2,006,135</u>	<u>2,006,135</u>

於2026年6月30日及2025年6月30日結束時的庫存股儲備及尚未發行庫存股數目詳情如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
於期初及期末	<u>891,776</u>	<u>891,776</u>
於期末的庫存股數目(千股)	<u>62,089</u>	<u>62,089</u>

25. 股份支付職工報酬

截至2026年及2025年6月30日止六個月，股份支付開支如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
以權益結算的股份支付報酬	<u>81,940</u>	<u>6,198</u>

(a) 限制性股票激勵計劃

根據本公司在2023年8月31日的2023年第二次臨時股東大會上批准的《合肥晶合集成電路股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)》(「**2023年激勵計劃**」)，授予激勵對象的20,061,351股限制性股票自授予完成之日起24個月後分三期歸屬，根據本集團績效考核(包括經濟增加值、淨利潤增長率及新工藝銷售收入佔收入的比例)及個人績效考核等相關情況，每期可歸屬的最高百分比為33.33%。本公司於2023年10月23日完成以每股人民幣10.07元的行權價格向396名激勵對象首次授予18,055,216股限制性股票，設有歸屬期。於2024年5月31日，本公司完成以每股人民幣10.07元的行權價格向6名激勵對象授予預留2,006,135股限制性股票，設有歸屬期。該激勵計劃的股票來源為本公司向激勵對象發行的本公司人民幣A股普通股股票。

根據本公司在2025年5月28日的2024年年度股東會上通過的《合肥晶合集成電路股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃(草案)》(「**2025年激勵計劃**」)，授予激勵對象的62,088,500股限制性股票將自授予完成之日起24個月後分三期歸屬，根據本集團績效考核(包括經濟增加值、營收增長率及稅息折舊及攤銷前利潤率)及個人績效考核等情況，每期可歸屬的最高百分比為33%、33%及34%。本公司於2025年6月26日完成以每股人民幣12.00元的行權價格向993名激勵對象首次授予59,388,500股限制性股票，設有歸屬期。於2025年10月29日，本公司完成以每股人民幣12.00元的行權價格向60名激勵對象授予預留2,700,000股限制性股票，設有歸屬期。股票來源為從二級市場購回的本公司A股普通股及／或本公司向激勵對象發行的A股普通股。

截至2025年及2026年6月30日止六個月，發行在外的限制性股票數目變動詳情載列如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
於期初	65,397	14,422
已授予	—	59,389
已失效	<u>(1,429)</u>	<u>(590)</u>
於期末	<u>63,968</u>	<u>73,221</u>

26. 具重大非控股權益之非全資附屬公司

有重大非控股權益的本集團附屬公司的詳情載列如下：

	於2026年 6月30日 %	於2025年 12月31日 %
非控股權益所持股權百分比：		
合肥皖芯集成電路有限公司(附註)	<u>66.25</u>	<u>61.56</u>

附註：

於2025年10月17日，本公司宣佈，其控股股東合肥市建設投資控股(集團)有限公司擬以現金出資人民幣3,000,000,000元，認繳本公司附屬公司合肥皖芯集成電路有限公司新增註冊資本約人民幣2,840,371,000元(以下簡稱「本次增資」)。於2025年11月及12月，合共收到人民幣1,400,000,000元，餘下人民幣1,600,000,000元則於2026年2月收訖。本次增資完成後，本公司持有合肥皖芯集成電路有限公司的股權百分比下降至33.75%，而非控股權益所持股權百分比則上升至66.25%。

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
分配至非控股權益的期內虧損：		
合肥皖芯集成電路有限公司	<u>(23,852)</u>	<u>(100,129)</u>
	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
非控股權益的累計餘額：		
合肥皖芯集成電路有限公司	<u>7,836,510</u>	<u>6,319,157</u>

下表列示上述附屬公司的財務資料概要。所披露金額為扣除任何公司間對銷前的金額：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
流動資產	4,170,019	2,530,409
非流動資產	20,058,802	16,596,950
流動負債	6,174,617	4,342,802
非流動負債	6,222,600	4,518,581
資產淨值	<u>11,831,604</u>	<u>10,265,976</u>
	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
收入	2,092,054	781,950
期內虧損	<u>(35,979)</u>	<u>(176,189)</u>
經營活動產生／(所用)的現金流量淨額	<u>169,591</u>	<u>(91,455)</u>

27. 已質押資產

本集團的若干資產已就借款質押。本集團已質押資產於2026年6月30日及2025年12月31日結束時的賬面值如下：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
物業、廠房及設備	3,995,232	4,112,850
限制性銀行存款	<u>108,569</u>	<u>—</u>
	<u>4,103,801</u>	<u>4,112,850</u>

28. 關聯方交易

本集團截至2026年及2025年6月30日止六個月訂立以下關聯方交易。

(a) 與關聯方的關係

關聯方名稱／姓名	與本集團的關係
合肥藍科投資有限公司	受合肥市建設投資控股(集團)有限公司控制
合肥合燃華潤燃氣有限公司 (前稱：合肥燃氣集團有限公司)	受合肥市建設投資控股(集團)有限公司控制
合肥水務集團有限公司 (前稱：合肥供水集團有限公司)	受合肥市建設投資控股(集團)有限公司控制
合肥市安居控股集團股份有限公司 (前稱：合肥市住房租賃發展股份有限公司)	受合肥市建設投資控股(集團)有限公司控制
合肥科微芯測科技有限公司	合肥市建設投資控股(集團)有限公司的聯營企業
合肥市鄉村振興投資有限責任公司	受合肥市建設投資控股(集團)有限公司控制
鼎信數智技術集團股份有限公司	受合肥市建設投資控股(集團)有限公司控制
安徽省合肥汽車客運有限公司	受合肥市建設投資控股(集團)有限公司控制
合肥方晶科技有限公司	本公司聯營企業
合肥方晶聯合半導體有限公司	受合肥方晶科技有限公司控制(自2025年3月起)
安徽晶鎂光罩有限公司	本公司聯營企業
安徽晶瑞光罩有限公司	安徽晶鎂光罩有限公司的附屬公司
蔡國智先生	執行董事兼董事長
周義亮先生	本公司副總經理

(b) 與關聯方的交易

截至6月30日止六個月		
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
銷售交易：		
合肥方晶科技有限公司	19,839	1,918
合肥方晶聯合半導體有限公司	—	2,673
安徽晶鎂光罩有限公司	71	—
安徽晶瑞光罩有限公司	32,241	—
	<u>52,151</u>	<u>4,591</u>
採購交易：		
合肥合燃華潤燃氣有限公司	11,898	13,113
合肥水務集團有限公司	13,242	10,956
合肥藍科投資有限公司	336	—
合肥市安居控股集團股份有限公司	307	358
鼎信數智技術集團股份有限公司	—	99
合肥科微芯測科技有限公司	—	68
合肥市鄉村振興投資有限責任公司	—	30
安徽省合肥汽車客運有限公司	185	—
安徽晶鎂光罩有限公司	25,201	—
	<u>51,169</u>	<u>24,624</u>
租金收入總額：		
安徽晶鎂光罩有限公司	134	—
安徽晶瑞光罩有限公司	62,814	—
合肥方晶科技有限公司	285	—
	<u>63,233</u>	<u>—</u>
租賃費用：		
合肥市安居控股集團股份有限公司	2,745	2,017
購買物業、廠房及設備以及土地使用權：		
合肥藍科投資有限公司	—	10,730

(c) 與關聯方的餘額

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
貿易應收款項：		
安徽晶鎂光罩有限公司	-	125,273
合肥方晶科技有限公司	6,361	2,483
合肥方晶聯合半導體有限公司	-	1,363
安徽晶瑞光罩有限公司	11,505	-
	<u>17,866</u>	<u>129,119</u>
	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
預付款項、其他應收款及其他資產：		
合肥合燃華潤燃氣有限公司	1,589	1,564
合肥市安居控股集團股份有限公司	1,443	2,178
合肥藍科投資有限公司	-	2,290
	<u>3,032</u>	<u>6,032</u>
	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
其他應付款：		
安徽省合肥汽車客運有限公司	20	20
安徽晶瑞光罩有限公司	214	61
安徽晶鎂光罩有限公司	8	3
蔡國智先生	-	1
周義亮先生	-	3
	<u>242</u>	<u>88</u>

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
貿易應付款項：		
安徽晶鎂光罩有限公司	13,115	4,519
安徽省合肥汽車客運有限公司	120	134
	<u>13,235</u>	<u>4,653</u>

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
合同負債：		
安徽晶鎂光罩有限公司	77	—
安徽晶瑞光罩有限公司	—	30,365
	<u>77</u>	<u>30,365</u>

(d) 本集團主要管理人員報酬

	截至6月30日止六個月 2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (未經審計)
袍金	300	300
薪金、津貼、獎金及實物福利	7,800	8,913
退休計劃供款	118	208
股份支付開支	10,383	576
其他長期職工福利	—	44
	<u>18,601</u>	<u>10,041</u>

(e) 擔保

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
合肥市建設投資控股(集團)有限公司就 本集團借款提供的擔保	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>

上文所載餘額為借款的尚未償還本金餘額。

29. 財務風險管理

本集團的業務令其面臨多項財務風險：外匯風險、價格風險、利率風險、信用風險及流動性風險。本集團的整體風險管理計劃專注於金融市場之不可預測性，並尋求盡量降低對本集團財務表現的潛在不利影響。風險管理根據董事批准的政策進行。董事就整體風險管理制訂原則。

中期財務資料並不包括年度財務報表規定的所有財務風險管理資料及披露，並應與本集團截至2025年12月31日止年度的合併財務報表一併閱覽。自2025年12月31日以來，風險管理政策概無變動。

30. 金融工具的公允價值計量

於合併財務狀況表中以公允價值計量的金融資產及負債分為3個公允價值層級。該3個層級根據計量輸入數據的可觀察性及重要性界定如下：

第1層級：相同資產及負債於活躍市場的報價(未經調整)。

第2層級：除第1層級所包含的報價外，資產或負債可直接或間接觀察的輸入數據，且並無使用重大不可觀察輸入數據。

第3層級：資產或負債的重大不可觀察輸入數據。

金融資產或負債整體分類的公允價值層級基於對公允價值計量而言屬重大的最低層級輸入數據。

下表按照計量公允價值所用估值技術輸入數據的層級分析本集團於2026年6月30日及2025年12月31日按公允價值列賬的金融工具。該等輸入數據於公允價值層級內歸類為以下3個層級：

- 相同資產或負債於活躍市場的報價(未經調整)(第1層級)；
- 除第1層級所包含的報價外，資產或負債可直接(即價格)或間接(即源自價格)觀察的輸入數據(第2層級)；及
- 並非依據可觀察市場數據的資產或負債輸入數據(即重大不可觀察輸入數據)(第3層級)。

(a) 公允價值層級

於2026年6月30日及2025年12月31日，根據上述3個層級劃分按經常性基準以公允價值計量的金融資產分析如下：

	第1層級	第2層級	第3層級	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2026年6月30日(未經審計)				
以公允價值計量且其變動計入				
當期損益的金融資產				
— 結構性存款、可轉讓大額存單及				
其他理財產品	—	1,309,228	—	1,309,228
— 非上市權益工具	—	—	1,700	1,700
— 上市權益工具	587,035	—	—	587,035
以公允價值計量且其變動計入				
其他綜合收益的金融資產				
— 上市權益工具	1,555,507	—	—	1,555,507
	<u>2,142,542</u>	<u>1,309,228</u>	<u>1,700</u>	<u>3,453,470</u>

	第1層級	第2層級	第3層級	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元

於2025年12月31日

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

—結構性存款、可轉讓大額存單及

收益憑證	—	1,475,436	—	1,475,436
------	---	-----------	---	-----------

—非上市權益工具

—	—	1,700	1,700
---	---	-------	-------

—上市權益工具

289,498	—	—	289,498
---------	---	---	---------

以公允價值計量且其變動計入

其他綜合收益的金融資產

—上市權益工具

501,964	—	—	501,964
---------	---	---	---------

—以公允價值計量且其變動計入

其他綜合收益的應收票據	—	—	6,063	6,063
-------------	---	---	-------	-------

<u>791,462</u>	<u>1,475,436</u>	<u>7,763</u>	<u>2,274,661</u>
----------------	------------------	--------------	------------------

(b) 用於釐定公允價值的估值技術

於活躍市場買賣的金融工具按市場報價釐定其公允價值；並非於活躍市場買賣的金融工具由本集團採用估值技術釐定其公允價值。所使用的估值模型主要為貼現現金流量法及市場法。估值技術的輸入數據主要包括預期收益率、近期交易價格及貼現率。

處於公允價值計量第2層級的資產主要包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的結構性存款、可轉讓大額存單及收益憑證。該等資產使用估值技術估值以釐定其公允價值。所使用的估值模型為同類型工具的市場報價或交易商報價。估值技術的輸入值主要包括合同約定的預期收益率。

處於公允價值計量第3層級的資產主要包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據、以公允價值計量且其變動計入當期損益的於非上市實體的股權投資。該等資產及負債主要使用貼現現金流量法及市場法計量。公允價值層級第3層級的判斷基於不可觀察輸入數據對整體公允價值計算的重要性。

截至2026年及2025年6月30日止六個月，第1層級與第2層級之間並無轉撥，亦無轉入或轉出第3層級。

有關2026年6月30日及2025年12月31日第2層級及第3層級公允價值計量的量化資料如下：

	公允 價值層級	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元	估值技術及 關鍵輸入數據	重大不可觀察輸入 數據的影響
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產					
－結構性存款	第2層級	701,046	500,285	預期收益率	預期收益率越高，公允價值越高
－可轉讓大額存單	第2層級	599,083	875,071	預期收益率	預期收益率越高，公允價值越高
－收益憑證	第2層級	－	100,080	預期收益率	預期收益率越高，公允價值越高
－其他理財產品	第2層級	9,099	－	預期收益率	預期收益率越高，公允價值越高
－非上市權益工具 (附註(a))	第3層級	1,700	1,700	市場法、近期 交易價格	近期交易價格越高，公允價值越高
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產					
－以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據 (附註(b))	第3層級	－	6,063	貼現率	貼現率越高，公允價值越低
		<u>1,310,928</u>	<u>1,483,199</u>		

附註：

- (a) 於2026年6月30日及2025年12月31日，倘近期交易價格上升／下降10%，則以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的非上市權益工具的公允價值將分別增加／減少約人民幣170,000元及人民幣170,000元。
- (b) 於2026年6月30日及2025年12月31日，倘貼現率上升／下降10%，則以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據的公允價值將分別減少／增加約零及人民幣1,036元。

31. 承擔

本集團中期財務資料中已訂約但未計提準備的資本承擔如下：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2025年 12月31日 人民幣千元
已訂約但未計提準備，扣除已付按金及預付款項		
—物業、廠房及設備	10,036,246	11,352,172
—認繳出資額	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>
	<u>10,136,246</u>	<u>11,452,172</u>

32. 或然事件

截至2026年6月30日及2025年12月31日，本集團並無重大或然項目。

33. 期後事件

於2026年7月10日，本公司H股於香港聯合交易所有限公司上市，當時本公司以公開發售方式按每股32.30港元(相當於人民幣28.02元)發行合共216,167,000股H股，以換取現金。

於2026年8月11日，本公司因超額配股權獲部分行使而於香港聯合交易所有限公司按每股32.30港元(相當於人民幣27.96元)發行合共10,886,900股H股。

管理層討論與分析

一、 報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

(一) 所處行業情況

1. 行業的發展階段、基本特點、主要進入門檻

公司主要從事12英寸晶圓代工業務。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)，公司所處行業為計算機、通信和其他電子設備製造業(C39)。根據國家統計局《戰略性新興產業分類(2018)》(國家統計局令第23號)，公司所處行業為戰略性新興產業分類中的「新型電子元器件及設備製造」(分類代碼：1.2.1)、「集成電路製造」(分類代碼：1.2.4)。

集成電路產業鏈是一個高度專業化和分工明確的產業鏈，呈現垂直化分工格局，上游包括集成電路材料、集成電路設備等；中游為集成電路生產，集成電路生產環節亦呈現垂直化分工格局，可以具體劃分為集成電路設計、集成電路製造、集成電路封測；下游為各類終端應用。

公司處於集成電路晶圓代工行業，專門負責晶圓製造，為集成電路設計公司提供晶圓代工服務。晶圓代工行業屬於技術、資本、人才密集型行業，其芯片製造工藝高度複雜、所需原材料和設備種類繁多、製造週期長，不僅需要全球產業鏈的支持，還依賴深厚的專業知識儲備、工程人才支撐以及持續的技術創新與工藝積累，因此行業具有較高的進入壁壘。

受下游市場需求拉動，全球晶圓代工市場近年增長態勢強勁，產業規模持續擴容。從競爭格局看，台積電等企業在先進製程領域佔據領先地位，國內企業雖在不斷追趕，但在核心技術、先進製程等方面仍與國際巨頭存在差距。在全球供應鏈格局深度調整與

地緣政治不確定性增加的背景下，國內企業不斷調整市場策略，持續加大研發投入，深耕特色工藝及特定細分市場，強化產業鏈協同，加速國產化替代，以成熟製程規模化優勢構建差異化競爭力。

2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

晶合集成是一家領先的12英寸晶圓代工企業，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢。根據TrendForce公佈的2026年第一季度全球晶圓代工業者營收排名，晶合集成位居全球第八位，在中國大陸企業中排名第三。

3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

(1) 顯示驅動芯片穩定發展中迎來新機遇

顯示驅動芯片是顯示面板的重要控制元件，廣泛應用於消費電子、汽車電子等領域，隨著應用場景持續拓展，新興領域正在成為行業增長主力。一方面，OLED在智能手機中的滲透率不斷提升，帶動高端顯示驅動芯片需求持續增長；另一方面，智能汽車的普及推動車載顯示快速發展，車規級顯示驅動芯片成為行業新的增長點。與此同時，超高清、Mini/Micro LED等新技術的落地，持續推動顯示驅動芯片需求升級。隨著中國大陸逐步成為顯示面板的全球製造中心，本土產業國產替代的步伐加快。在LCD顯示驅動領域，本土廠商正奮起直追，市場份額持續提升；而在技術壁壘更高的AMOLED顯示驅動芯片領域，韓國企業仍佔據領先技術優勢，本土廠商目前仍處於攻堅滲透的階段。顯示驅動芯片需求的擴張與國產替代進程加快，直接帶動了國內晶圓代工企業訂單增長，依託28nm-150nm的成熟製程優勢，本土晶圓代工廠已經成為國產替代供應鏈中核心受益環節。

公司已具備150nm至40nm主流技術節點的DDIC代工能力，實現40nm高壓OLED DDIC量產，並持續進行技術平台升級。報告期內，28nm OLED及110nm高像素密度高階硅基OLED顯示驅動芯片產品驗證中。

(2) CIS市場規模持續擴張，國產化進程加快

CIS是攝像頭的核心組件，是一種將光學影像轉換為數字信號的半導體器件，廣泛應用於消費電子、安防監控及智能車載等領域。近年來，受益於智能手機多攝方案的持續普及，安防設備朝著高清化、智能化、暗光成像方向升級迭代，以及智能駕駛落地帶動車載視覺傳感器搭載量大幅提升，全球CIS市場規模持續擴張。目前，儘管索尼等海外巨頭仍主導高端市場格局，但中國大陸企業在國家政策的支持下，正通過技術突破與產品迭代加速追趕並鞏固細分優勢，逐漸提升中國CIS市場規模在全球市場中的比重。CIS行業整體國產化率的提升，離不開本土產業鏈協同的深化，國內CIS廠商多以Fabless為主，通過與本土晶圓代工廠建立深度合作，獲得穩定的產能支持，同步帶動了中國CIS代工產能的快速增長。

公司CIS產品製程覆蓋90nm-55nm，廣泛用於智能手機主攝、輔攝及前攝鏡頭、安防監控攝像頭以及車載攝像頭等場景。報告期內，公司55nm高效能高動態範圍成像技術圖像傳感器工藝平台開發完成，90nm高階近紅外感光圖像傳感器實現小批量生產。

(3) 下游應用發展帶動電源管理芯片需求增長

電源管理芯片是在電子設備系統中實現對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理職責的芯片，是電子產品和設備的電能供應中樞和紐帶，是電子產品中不可或缺的關鍵器件，廣泛應用於消費電子、汽車電子、工業控制、通信等主要領域。近年來，隨著下游應用場景不斷拓展到AI服務器、人工智能、低空經濟、智能家居等，電源管理芯片行業迎來了新的發展機遇。在高性能計算電源芯片領域，AI服務器等對功率密度與轉換效率提出了更高要求，持續推動全球DrMOS (Driver MOSFET)市場擴容。現階段海外主流DrMOS廠商優先保障海外頭部客戶供貨，造成國內市場DrMOS供給缺口顯著，這為本土電源管理芯片廠商打開了國產替代的機遇窗口，上游代工廠商亦深度受益。

2026年上半年電源管理芯片佔收入的比例為12.82%，較上年同期的12.07%提升0.75個百分點，電源管理芯片已成為公司第三大產品主軸。目前，公司已開展AI服務器相關電源管理芯片研發，產品持續驗證中。

(4) 邏輯芯片國產化提升空間巨大

邏輯芯片是指包含邏輯關係，以二進制為原理，實現運算與邏輯判斷功能的集成電路，其功能涵蓋算術邏輯運算、時序控制、數據存儲與傳輸、接口協議處理、錯誤校驗等，廣泛應用於計算機、通信設備、消費電子、人工智能、自動駕駛及工業控制系統，市場需求廣闊。隨著AI爆發式發展，廣泛應用於各類電子設備及系統的內存芯片(DRAM)需求急速上漲，但隨著DRAM平面架構演進逼近極限，通過工藝製程的微縮提升單位內存芯片容量的方式正逐漸失去可行性。為高效利用單位芯片的有限面積，將控制邏輯等的外圍電路，置於存儲陣列之下或之間的CBA (CMOS Bonded Array)技術成為優化

DRAM系統性能的關鍵，這為半導體製造帶來了新的機遇。儘管先進製程邏輯芯片仍由國際巨頭主導，但成熟製程邏輯芯片在規模龐大、增長穩健的非高性能場景中仍佔據主導地位。隨著供應鏈國產化需求的提升，本土邏輯芯片設計企業與本土晶圓代工廠協同持續深化，本土晶圓代工廠憑藉在成熟製程的優勢迅速擴大產能規模。

公司已實現150nm、110nm和55nm邏輯芯片量產，且同時與戰略客戶展開深度合作，目前28nm邏輯工藝平台已導入客戶樣品流片驗證中，22nm邏輯芯片工藝開發中。

(5) 汽車半導體市場增長帶來新動力

伴隨汽車智能化滲透率穩步上行，車載電子迎來需求爆發，同步拉動車載DDIC、CIS、PMIC、MCU和專用邏輯芯片的市場需求。新車座艙屏幕搭載數量不斷增加，帶動車規顯示驅動芯片需求上漲；輔助駕駛方案所用攝像頭配置大幅擴容，助推車載圖像傳感器放量；新能源車搭載各類車載電控模塊，提升了電源管理芯片的使用規模；為了支持多屏互動，單車搭載的微控制單元用量快速增加，車載信號傳輸與接口配套也帶動專用邏輯芯片穩步增長。隨著國產汽車電動化、智能化轉型的持續推進，疊加芯片國產替代加速，車規級芯片的代工需求大量湧現，國內晶圓代工廠依託成熟製程產能優勢得以受益。

公司積極配合汽車產業鏈的需求，佈局車用芯片市場。在汽車芯片製造能力建設上，公司已取得國際汽車行業質量管理體系認證，並通過多個工藝平台的車規驗證。報告期內公司有多個車用產品實現批量生產。

(二) 主要業務、產品情況

公司主要從事12英寸晶圓代工業務，致力於研發及應用行業先進的工藝，為客戶提供不同工藝平台、多種製程節點的晶圓代工服務。

在晶圓代工製程節點方面，公司目前已實現150nm至40nm製程平台的量產，28nm邏輯工藝平台已導入客戶樣品流片驗證中，22nm邏輯芯片工藝開發中。在工藝平台應用方面，公司目前已具備DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU等工藝平台晶圓代工的技術能力。公司產品主要應用於消費電子、汽車電子、工業控制、人工智能、物聯網及存儲等領域。

(三) 主要經營模式

1. 研發模式

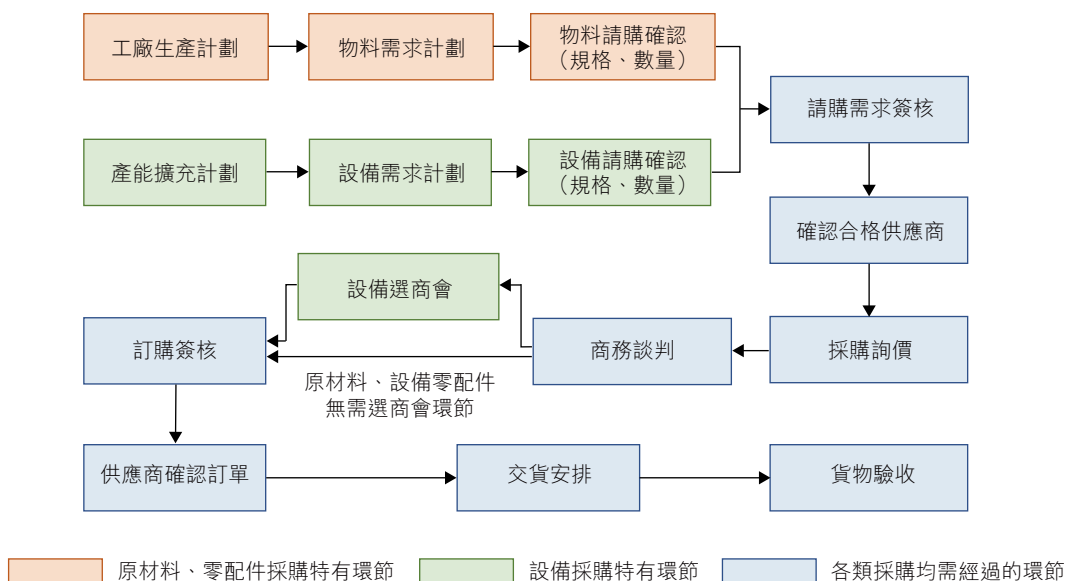
公司制定了研發管理制度，明確了研發過程中各部門的權責關係與作業流程，確保研發過程符合公司策略發展方向，實現經營效益最大化。公司研發流程包括市場調查、策略制定、可行性評估、項目審查、項目立項、技術開發、流片、工藝製程驗證、項目結案等環節。

為保證研發效率及成本控制，公司還制定了嚴格的研發進度管控方案，覆蓋前期產品市場信息匯整、策略方向討論、可行性評估、項目審查以及研發的各個環節。

2. 採購模式

公司的供應商主要包括原材料供應商和設備供應商，公司通常採用直接採購模式，如果終端供應商採取經銷模式進行銷售，則公司也可通過經銷商向終端供應商進行採購。

為加強成本控制、保證晶圓代工服務質量、提高生產效率和存貨周轉效率，公司建立了嚴格的採購流程，具體如下：



公司建立了完善的供應商認證準入機制和嚴格的供應商考核評價體系，以保證原材料、設備零配件及設備質量的穩定性和供應的持續性。供應商經過資質評估、採購效益評估、入廠評估等環節評估通過後，方可成為公司的合格供應商，公司主要向進入公司合格供應商名單的供應商進行採購。為實現對合格供應商的有效管理，相關部門會對採購產品的質量、價格、服務等進行考核評價。

3. 生產模式

公司接到客戶需求後，首先進行小規模試產；在良率及工藝條件穩定後，進入風險量產階段；在各項交付指標達標後，與客戶簽訂正式的銷售合同或接受批量訂單，按照客戶需求分配產能、制定生產計劃、進行大批量生產。

4. 銷售模式

公司建立了規範、完整的銷售團隊，擁有多元化的營銷渠道，通過不同的營銷方式拓展客戶。主要方式如下：

- (1) 通過市場分析，挖掘潛在客戶，並主動與潛在客戶進行溝通，舉辦業務洽談會，主動向客戶推薦符合客戶需求的技術平台；
- (2) 通過與晶圓代工上下游的企業及行業協會溝通交流，開發潛在客戶；
- (3) 通過參與學術交流、半導體峰會、行業展會、技術論壇、企業論壇等活動，塑造公司形象，獲取潛在客戶；
- (4) 通過公司官網、新聞媒體等公開渠道，展示公司的工藝平台與技術水平，由潛在客戶主動聯繫公司開展業務合作。

公司採用直銷模式進行銷售，並制定了相應的銷售管理制度，對銷售流程進行規範。公司銷售流程如下：客戶需求可行性評估、依據產品規格對產品報價、接收客戶訂單、生產製造、出貨至客戶指定地點、客戶付款。

二、經營情況的討論與分析

(一) 經營業績

報告期內公司積極推進境內外市場拓展和各項業務發展，訂單充足，產能利用率持續處於高位水平，收入規模穩定增加；公司結合市場動態、客戶需求及自身發展戰略，持續進行產能擴充、拓展產品應用領域及開發高階工藝平台，相關折舊攤銷不斷增加，疊加產品價格波動，導致毛利率水平短期下滑。

報告期內，我們實現收入人民幣5,765,812千元，較上年同期的人民幣5,129,794千元增長12.40%；本公司擁有人應佔期內利潤為人民幣245,373千元，較上年同期的人民幣332,129千元下降26.12%；經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2,797,992千元，較上年同期的人民幣1,705,036千元增長64.10%。2026年上半年我們的毛利率為21.38%。

(二) 業務發展

公司主要從事12英寸晶圓代工業務，具備DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU等工藝平台代工技術能力。公司已實現150nm至40nm製程平台的量產，28nm邏輯工藝平台已導入客戶樣品流片驗證中，22nm邏輯芯片工藝開發中。

公司不斷豐富產品種類、優化產品結構，提升毛利水平。報告期內，我們實現收入人民幣5,765,812千元，從製程節點分類，55nm及以下、90nm、110nm、150nm佔收入的比例分別為14.29%、39.38%、26.72%、19.61%；從應用產品分類，DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU佔收入的比例分別為53.24%、25.34%、12.82%、4.02%、4.25%，其中CIS和PMIC產品收入佔比不斷提升。

(三) 研發進展

報告期內，我們的研發投入金額達人民幣759,497千元，較上年同期的人民幣694,820千元增長9.31%，佔收入的13.17%。報告期末我們共有員工5,738人，其中研發人員1,938人，佔比33.77%。報告期內我們新獲得發明專利240個、實用新型專利37個。截至報告期末我們累計獲得專利1,648個。

報告期內，公司研發進展順利，取得了顯著的成果，新產品逐步導入市場，如90nm高階近紅外感光圖像傳感器實現小批量生產。

(四) 人才團隊建設

公司通過內部培訓、在線學習平台、外派訓練等方式，為員工提供學習資源，促進員工與公司共同發展。公司還與北京大學、南京大學、浙江大學、合肥工業大學、安徽大學、北京航空航天大學等高校院所開展多種形式的校企合作，構建全面的人才聯合培養體系。

三、報告期內核心競爭力分析

(一) 核心競爭力分析

1. 研發團隊經驗豐富，技術實力行業領先

公司研發團隊核心成員均由境內外的資深專家組成，在不同的技術方向具有豐富的研發經驗，對行業發展現狀和趨勢有著深刻的認識和理解。公司堅持以行業發展趨勢和客戶需求為導向，積極探索新的業務領域，及時進行產品迭代，滿足終端客戶的需求。通過多年持續的研發投入，公司積累了深厚的技術儲備和豐富的研發經驗，截至報告期末，我們共取得專利1,648個，其中發明專利1,294個、實用新型專利354個。報告期內，我們的研發投入金額達人民幣759,497千元，較上年同期的人民幣694,820千元增長9.31%。報告期末我們擁有員工5,738名，其中研發人員1,938名，佔員工總數比例為33.77%，研發人員中碩士及以上佔比約67.29%。

2. 產品結構不斷豐富，工藝平台多元發展

公司已實現DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU等工藝平台量產，產品結構日益多樣化，產品應用涵蓋消費電子、汽車電子、工業控制、人工智能、物聯網及存儲等領域。報告期內，公司不斷推出有市場競爭力的新產品，進一步優化產品結構，DDIC收入佔比逐漸下降，CIS、PMIC收入佔比不斷提升。

3. 位居合肥戰略核心，產業鏈協同效應強

公司地處國家級科創試點城市合肥。合肥憑藉「芯屏汽合」產業戰略，已形成新型顯示、集成電路、新能源汽車及人工智能等新興產業集群，並集聚了眾多集成電路產業鏈上下游重點企業，構建了覆蓋設計、製造、封裝測試、裝備材料及公共服務平台的完整生態。作為集成電路產業鏈的核心環節，公司充分發揮本地終

端市場距離近、規模大的優勢，依靠成熟製程製造經驗，深度融入合肥產業鏈佈局，提供關鍵芯片供給，有力促進產業鏈協同聯動，共建穩定共贏的產業生態圈。

4. 穩定靈活的產能供應，客戶關係緊密穩固

作為領先的晶圓代工企業，公司為客戶提供穩定靈活的產能規劃、全面的技術支持與可靠的產品交付。公司高度重視關鍵客戶的定制化需求，通過共同開發與工藝驗證，滿足其特定應用，保障客戶在快速發展的終端市場競爭中的確定性及靈活性，進而深化客戶粘性。這種深度合作不僅助力公司精準洞察市場與技術趨勢、縮短產品上市時間並提升整體產品性能，更構建了長期穩固的客戶網絡，為可持續增長奠定堅實基礎，並贏得了眾多境內外知名芯片設計與終端產品企業的廣泛認可。

5. 體系認證齊全，質量穩定可靠

公司建立了完善的質量管理體系，依託產品研發及工藝技術的綜合實力保證並提升產品品質。截至目前，公司已取得質量管理體系認證ISO9001、環境管理體系認證ISO14001、職業健康安全管理体系認證ISO45001、有害物質過程管理體系認證QC080000、溫室氣體排放盤查認證ISO14064、能源管理體系認證ISO50001：2018等諸多認證。此外，在車用芯片領域，公司已取得車載質量管理體系IATF16949認證。

6. 智能化工廠運營和本地集中化產業鏈優勢

公司已整合智能製造系統及AI智能製造工具，構建覆蓋生產全流程的智能化體系。智能生產線配備了先進的智能製造運營管理系統，包括數字化生產系統、自動化無人搬運系統、車間自動化控制系統、智能品質與設備監控系統及智能生產派工系統等，顯著提升了生產效率與質量管理水平。通過智能化生產，公司為客戶

提供了卓越的代工服務與穩定可靠的產品質量，通過將人工智能技術全面融入研發與運營等核心環節，公司有效地提升管理效能、降低運營成本，實現了AI驅動的智能製造升級與全局優化。

公司所有產能均集中於中國合肥的同一廠區，通過在此基礎上有序、穩步地擴充產能，可有效減少重複建設，自動化晶圓傳送系統貫穿整個廠區，將顯著降低對進口材料及設備的依賴，縮短採購交期，增強供應鏈穩定性。高度一體化的生產基地、智能生產及本土化供應鏈支持，使公司具備更高效率、更佳質量及更雄厚的成本競爭力。

(二) 核心技術與研發進展

1、核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況

報告期內公司完成了110nm高壓電源管理芯片技術平台、150nm電源管理芯片技術平台以及功率半導體技術平台的研發。公司已量產的晶圓代工核心技術及先進性如下：

序號	產品應用		技術參數與工藝特點	終端應用領域	技術	
	領域類別	技術平台			技術來源	先進性
1	DDIC	40nm OLED顯示驅動平台	核心組件電壓：1.1V 輸入/輸出電壓：8V，並提供高壓32V 低功耗型的氮氧化硅技術(Poly SiON)	高階智能手機、穿戴設備等電子產品	自主研發	國際主流
		55nm OLED顯示驅動芯片技術平台	核心組件電壓：1.2V 輸入/輸出電壓：8V，並提供高壓32V 採用銅製程技術	高階智能手機、穿戴設備等電子產品	自主研發	國際主流
		55nm觸控與顯示驅動整合技術平台	核心組件電壓：1.2V 輸入/輸出電壓：6V，並提供高壓32V 採用銅製程技術	高階智能手機、穿戴設備等電子產品	自主研發	國際主流

產品應用					技術	
序號	領域類別	技術平台	技術參數與工藝特點	終端應用領域	技術來源	先進性
2	CIS	90nm顯示驅動平台	核心組件電壓：1.32V 輸入/輸出電壓：6V，並提供高壓32V 採用鋁製程技術	高階智能手機、平板電腦、手錶等電子產品	技術引進並創新升級	國際主流
		110nm顯示驅動芯片平台	核心組件電壓：1.2/1.5V 輸入/輸出電壓：5/6V，並提供高壓32V 金屬層進行90%尺寸微縮，採用鋁製程技術 採用低漏電元件技術	智能手機、筆記本電腦、平板電腦、LED廣告牌、LED背光	技術引進並創新升級	國際主流
		150nm顯示驅動芯片平台	核心組件電壓：1.8V/3.3V 輸入/輸出電壓：13.5V/18V	4K/8K電視顯示屏、電腦顯示屏	技術引進並創新升級	國際主流
		90nm CMOS圖像傳感器平台	核心組件電壓：1.2V/1.32V 輸入/輸出電壓：2.8V/3.3V 具備前/後照式技術	手機攝像頭芯片、3D識別芯片、安防監控芯片、車載攝像頭等	自主研發	國內領先
		55nm CMOS後照式圖像傳感器平台	核心組件電壓：1.2V 輸入/輸出電壓：2.5V 具備前/後照式技術	智能手機、安防、無人機、遊戲娛樂、工業自動化等	自主研發	國內領先
3	PMIC	110nm高壓電源管理芯片技術平台	核心組件電壓：1.5V 輸入/輸出電壓：5V 高壓5V至120V等	DC-DC、快充、電池管理(BMS)	自主研發	國內主流
		150nm PMIC手機高壓電源管理芯片技術平台	核心組件電壓：1.8V 輸入/輸出電壓：3.3V/5V	智能手機電源管理芯片	自主研發	國內領先
		150nm電源管理芯片技術平台	核心組件電壓：1.5V 輸入/輸出電壓：5V 高壓5V至80V等	智能手機、平板電腦、工業控制等	自主研發	國內主流

產品應用					技術	
序號	領域類別	技術平台	技術參數與工藝特點	終端應用領域	技術來源	先進性
4	MCU	新一代110nm 加強型微 控制器平台	核心組件電壓：1.5V 輸入／輸出電壓：5V MTP容量大小：32kx8 bits 讀寫次數：10k cycles 嵌入式flash	智能家電芯片、 物聯網芯片	自主研發	國內主流
5	Logic	55nm銅製程 研發	核心組件電壓：1.2V/2.5V	圖像信號處理器、 閃存控制器	自主研發	國際主流
6	E-tag	90nm高階顯示 驅動芯片工藝 平台	核心組件電壓：1.32V 輸入／輸出電壓：6V，並提供高壓40V	電子標籤、電子紙等 電子產品	自主研發	國際主流
		110nm電子標籤 驅動芯片平台	核心組件電壓：1.5V 輸入／輸出電壓：6V，並提供高壓40V 高壓元件為溝道隔離元件，可大幅 縮小尺寸	電子標籤及便攜式 裝置	自主研發	國內領先
7	MOSFET	功率半導體 技術平台	器件耐壓：40V至1200V 提供溝槽式、分離柵工藝，優化器件耐壓	工業電機控制、 車用電機等	自主研發	國內主流

2、報告期內獲得的研發成果

報告期內，公司通過整合現有研發資源，優化研發配置，針對關鍵研發重點、難點進行集中攻堅，在高階車用及旗艦手機攝像頭領域持續突破，具體如下：

- (1) 55nm高效能高動態範圍成像技術圖像傳感器工藝平台開發完成；
- (2) 90nm高階近紅外感光圖像傳感器實現小批量生產。

報告期內獲得的知識產權列表

	本期新增		累計數量	
	申請數 (個)	獲得數 (個)	申請數 (個)	獲得數 (個)
發明專利	235	240	1,689	1,294
實用新型專利	42	37	487	354
軟件著作權	6	3	20	14
其他	8	8	29	21
合計	291	288	2,225	1,683

3、研發投入情況表

單位：人民幣千元

	本報告期 (未經審計)	上年同期 (未經審計)	變化幅度
費用化研發投入	609,227	694,820	-12.32%
資本化研發投入	150,270	-	不適用
研發投入合計	759,497	694,820	9.31%
研發投入總額佔 收入比例(%)	13.17	13.54	減少0.37個 百分點
研發投入資本化的比重(%)	19.79	-	增加19.79個 百分點

研發投入資本化的比重大幅變動的原因及其合理性說明

本期研發投入資本化的比重較上年同期增加19.79個百分點，主要系報告期內符合資本化條件的研發項目進入開發階段，本集團將相關研發開支予以資本化。

4、 在研項目情況

單位：人民幣千元

序號	項目名稱	預計總 投資規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或 階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
1	22nm工藝技術 研發項目	1,890,011	65,488	95,523	技術開發階段	完成平台開發，包括全套低、中、高壓器件，提供低功耗，高效能的元件方案供客戶設計，並實現批量生產	國際主流	時序控制，WiFi、射頻、OLED驅動、圖像處理芯片
2	28nm高效能邏輯 工藝平台	1,965,000	106,066	161,601	技術開發階段	完成平台開發，包括全套低、中、高壓器件，提供低功耗，高效能的元件方案供客戶設計，並實現批量生產	國際主流	時序控制，WiFi、射頻、OLED驅動、圖像處理芯片、存儲運算芯片
3	28nm邏輯及OLED 芯片工藝平台	2,903,176	84,479	1,545,349	產品驗證階段	完成平台開發，包括全套低、中、高壓器件，提供高容量SRAM，降低功耗，適應各種高端顯示技術需求	國際主流	視頻SoC、圖像處理(ISP)、信號傳輸及視頻橋接芯片、時序控制芯片、內存控制器、FPGA、CPU、高階智能手機OLED屏
4	55nm高階顯示 驅動芯片 技術平台	205,850	41,745	48,866	風險量產階段	完成平台開發，提供高密度、高可靠性SRAM及RRAM，適應各種高端顯示技術需求	國際主流	智能手機OLED屏、筆記本電腦OLED屏、車用AR HUD、AR眼鏡
5	55nm增強型邏輯 芯片技術平台	45,000	24,673	37,828	風險量產階段	完成平台開發，包括全套低、高壓器件，提供高容量SRAM，導入客戶並實現批量生產	國內主流	時序控制芯片、高速傳輸、解碼譯碼、無線耳機

序號	項目名稱	預計總 投資規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或 階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
6	65nm高速光傳輸芯片技術平台	348,000	-	-	技術開發階段	完成平台開發，提供高傳輸速率光芯片工藝技術供客戶設計並實現批量生產	國際主流	AI服務器
7	90nm新型顯示驅動芯片工藝平台	34,850	10,986	11,344	技術開發階段	開發高壓組件，提高驅動能力，導入客戶並實現批量生產	國際主流	電子標籤、電子紙等電子產品
8	110nm高階顯示驅動芯片工藝平台	223,540	26,402	170,631	風險量產階段	完成平台開發，滿足車規、超低漏電等多種工藝需求，實現產品批量生產	國際主流	VR眼鏡/AR眼鏡/抬頭顯示/輔助顯示/車用LCD面板/儀錶板/筆記本電腦
9	55nm高效能CMOS圖像傳感器平台	50,800	22,147	32,293	工藝製程驗證階段	完成55納米高效能CMOS圖像傳感器平台開發，並實現批量生產	國內領先	智能手機、遊戲娛樂等
10	90nm高效能CMOS圖像傳感器平台	23,100	30,585	66,037	工藝製程驗證階段	完成90納米高效能CMOS圖像傳感器平台開發，並實現批量生產	國內主流	高端安防，車載攝像頭等
11	110nm高階微控制器平台	207,730	9,968	184,745	風險量產階段	完成平台開發，通過車規級可靠性驗證，導入客戶並實現批量生產	國內主流	智能家電、辦公設備及PC/筆記本電源、視頻轉接口芯片等
12	90nm BCD電源管理芯片技術平台	109,050	21,766	88,321	工藝製程驗證階段	完成平台開發及AEC-Q100車規可靠性測試，導入客戶並實現批量生產	國內主流	接口芯片、快充協議芯片、手機電源管理芯片、AI服務器等
13	新一代150nm電源管理芯片技術平台	24,800	4,080	4,080	技術開發階段	完成平台開發，降低器件導通電阻，提高器件耐壓，導入客戶產品並實現批量生產	國內主流	高階手機電源管理芯片
合計	/	<u>8,030,907</u>	<u>448,385</u>	<u>2,446,618</u>	/	/	/	/

5、研發人員情況

基本情況

	本期數	上年同期數
公司研發人員的數量(人)	1,938	1,924
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	33.77	35.03
研發人員薪酬合計(人民幣千元)	358,506	333,691
研發人員平均薪酬(人民幣千元)	184	178

教育程度

學歷構成	數量 (人)	比例 (%)
博士研究生	11	0.57
碩士研究生	1,293	66.72
本科	515	26.57
專科及以下	119	6.14
合計	1,938	100.00

年齡結構

年齡區間	數量 (人)	比例 (%)
30歲以下(不含30歲)	968	49.95
30-40歲(含30歲，不含40歲)	832	42.93
40-50歲(含40歲，不含50歲)	90	4.64
50-60歲(含50歲，不含60歲)	43	2.22
60歲及以上	5	0.26
合計	1,938	100.00

四、風險因素

(一) 核心競爭力風險

1. 研發人員不足或流失風險

集成電路晶圓代工行業不僅是資本、技術密集型行業，同時也具有人才高度密集型特徵。隨著集成電路行業競爭持續加劇，懂行業、精技術、善管理的人員團隊是公司持續發展的基石，人才現已成為公司關鍵的戰略資源。為此，公司將人才梯隊建設置於重要位置，通過實施員工持股計劃、股權激勵、完善職業發展通道等多元化舉措，積極吸引並留住高端技術人才，現已組建起一支經驗豐富、穩定可靠、創新能力卓越的核心研發團隊，在新產品與先進製程的研發及量產方面發揮了關鍵作用。儘管正常範圍內的人才流動通常不會對研發與經營造成重大不利影響，但若未來核心技術人員出現較大範圍的流失，仍可能在一定時期內對相關項目的研發進度、技術迭代及工藝穩定性帶來挑戰，從而對公司的市場競爭地位產生不利影響。

2. 產品開發風險

集成電路晶圓代工行業技術複雜程度高、迭代速度快，且下游應用需求多元。公司需持續進行高強度的研發投入，以跟進技術發展趨勢並響應客戶需求。然而，新工藝平台從研發、驗證到最終實現規模化量產，通常研發週期長、資金投入大且結果存在不確定性。若公司未能及時完成關鍵技術迭代，或性能及良率不達標準，可能導致新產品無法順利開發完成或無法通過客戶的認證，致使公司發展後勁不足，在市場競爭中處於不利地位。

3. 核心技術外洩或失密風險

經過多年的技術創新和研發積累，公司儲備了一系列具有自主知識產權的核心技術，擁有覆蓋研發及生產全流程的上千項專利。同時，公司仍在持續進行多項針對主營業務的技術研發工作，累積了眾多的實驗數據、工藝參數、設計圖紙等商業秘密。公司十分重視對核心技術的保護工作，通過申請專利、計算機軟件著

作權、集成電路佈圖設計等方式對核心技術進行有效保護，並制定了保密制度，對核心技術人員在保密義務、知識產權等方面作出了嚴格規定。同時，通過對訪問權限劃分、敏感信息監控等方式加強網絡安全管理，以保護公司的合法權益，防止核心技術外洩。但由於技術秘密保護措施的局限性及其他不可控因素，在人員流動、上下游業務交流的過程中，公司的技術和研發成果仍面臨一定的洩密風險，從而對公司核心競爭力產生風險。

(二) 經營風險

1. 客戶集中度較高的風險

報告期內，我們前五大客戶的收入合計人民幣3,396,037千元，佔收入的比例為58.90%，客戶集中度較高。公司憑藉自身的研發能力、產品品質、產能支持、客戶服務等綜合能力，已與主要客戶保持了良好的合作關係並與部分客戶簽署了長期合作的框架協議。但未來若公司的主要客戶因產品佈局優化、技術路徑轉變、下游需求變化等因素調整採購策略，或者公司自身在產品研發、產能供應等方面未能持續滿足客戶需求，導致訂單量大幅下降、價格下調，且公司未能及時開拓足量新客戶以彌補需求缺口，將可能對公司生產經營和盈利能力產生不利影響。

2. 新產品需求不及預期風險

公司一直重視新產品、新製程和特色工藝平台的研發工作，目前公司90nm高階近紅外感光圖像傳感器實現小批量生產，28nm邏輯工藝平台已導入客戶樣品流片驗證中，22nm邏輯芯片工藝開發中，新產品的陸續研發完成並通過認證及量產，將會給公司經營業績帶來新的增長點。然而，開發新技術平台及實現商業化，所需的資金、時間成本高，疊加市場需求及行業競爭態勢變化等多

重不確定性。若公司新產品落地時無法滿足現時市場需求或未能獲得客戶的充分認可，可能導致研發投入無法取得預期回報，從而影響公司的成長速度與盈利能力。

3. 公司產品結構相對集中的風險

公司主要從事12英寸晶圓代工業務，目前的主要產品包括DDIC、CIS、PMIC、Logic和MCU，雖然報告期內我們的收入主要來自於DDIC，該產品收入佔比約為53.24%，但是較上年同期的60.61%下降7.37個百分點，CIS產品的收入佔比較上年同期提升4.83個百分點，產品結構有所改善。公司目前正在進行新技術平台的研發和持續優化工作，並積極開拓市場，但新產品形成規模收入尚需時間。短期內，如果面板顯示驅動芯片市場、圖像傳感器市場需求下降，導致公司在該領域的生產或銷售出現不利變化，則可能對公司的盈利能力、經營性現金流產生不利影響。

4. 公司無法及時消化新增產能的風險

為把握市場機遇，公司依據市場環境、客戶需求、公司發展戰略等進行彈性產能擴充，並已進行了深入的市場調研和可行性分析，在技術工藝、市場開拓、人員儲備等方面做好了充分準備，但產能建設與釋放需要一定週期，外部環境的不確定性仍可能帶來挑戰。未來若宏觀經濟環境、國家產業政策或技術發展方向發生重大變化，導致下游市場增速不及預期、公司主要客戶需求改變，或其他同業競爭者加速擴產導致市場供需失衡等情形，公司將面臨產能釋放節奏和市場需求節奏不匹配致使無法及時消化新增產能的風險，進而導致產能利用率下滑、物業、廠房及設備折舊壓力增大，對公司的經營業績造成不利影響。

(三) 財務風險

1. 物業、廠房及設備建設投資的風險

公司所處的集成電路行業是典型的資本密集型行業，物業、廠房及設備投資規模較大。為把握市場機遇、提升客戶服務能力及強化市場地位，公司持續推進產能擴張戰略。儘管已制定審慎的資本開支計劃並配套多元化融資方案，但在產能實際建置過程中，受制於宏觀經濟波動、貨幣政策調整及資本市場融資環境變化等不可控因素，公司可能面臨一定的資金壓力。與此同時，隨著大額物業、廠房及設備的增加，折舊費用也將相應上升，但經濟效益提升需要一定的時間，若公司未來產銷規模的增長無法消化大額物業、廠房及設備投資帶來的新增折舊，可能會對公司的盈利水平產生階段性壓力。

2. 存貨跌價風險

報告期末，我們的存貨賬面價值為人民幣1,590,023千元，佔總資產比例為2.70%；存貨跌價準備金額為人民幣39,123千元，對應存貨期末餘額的計提比例為2.40%。公司的生產策略以銷售訂單為核心，並考慮客戶的中期需求來制定生產計劃，進行適度備貨，以保證銷售與生產的匹配與銜接。若未來市場環境發生不利變化、客戶需求出現非預期調整或技術迭代加速，而公司未能及時有效應對並做出相應調整，將導致產品滯銷、存貨積壓，公司將面臨存貨跌價的風險。

3. 毛利率波動風險

報告期內，受產品結構、競爭壓力、產品價格等因素影響，公司毛利率有一定的波動。公司的產品規格數量較多，不同製程和品類的產品在價格與毛利率上存在一定差異，產品結構的調整將直接影響毛利率水平。同時，公司成本結構中以固定成本為主，主要包含廠房、設備折舊等，因此價格和稼動率的波動對毛利率影響

較大。未來，如果市場供需關係、公司議價能力、技術發展趨勢等發生重大不利變化，導致公司收入規模出現顯著波動，或流失高毛利率業務，或新增產能未達預期稼動率，公司將面臨毛利率波動甚至下滑的風險。

4. 外幣匯率波動風險

報告期內，公司存在境外銷售及採購的情況，並主要通過美元或日元進行結算，公司相應持有美元、日元等外幣貨幣性資產。雖然公司在業務開展時已考慮了訂單簽訂及款項收付期間匯率可能產生的波動，也持續平衡外幣貨幣性資產規模以降低匯兌損益對經營業績的影響，但如果未來境內外經濟環境、政治形勢、貨幣政策等因素發生變化，使得外幣匯率大幅波動，公司有可能面臨匯兌損失的風險。與此同時，如果結算匯率短期內波動較大，公司境外原材料採購價格和產品銷售價格也將受到影響，進而可能對經營業績造成不利影響。此外，我們在香港設立公司開展業務，其後公司於2026年7月10日在香港聯交所掛牌上市，港幣匯率的波動亦可能導致我們承擔匯兌損失。

(四) 行業風險

1. 產業政策變化風險

集成電路產業是我國的戰略性支柱產業，近年來國家陸續出台文件進行積極引導，自上而下地為行業構建了系統性的支持體系。各級地方政府亦同步配套稅收優惠、融資支持、財政補貼、人才引進及知識產權保護等一攬子舉措，為產業鏈各環節企業營造了良好的發展環境。在政策驅動下，國內集成電路行業在芯片設計研發、先進製程工藝突破及關鍵核心技術自主可控等方面取得顯著進步。若未來產業政策方向發生調整(如財稅優惠退坡、補貼力度減弱或行業準入規則變化等)，可能對公司技術研發、高端人才儲備及產能擴張節奏產生潛在不利影響。

2. 行業競爭加劇的風險

近年來，集成電路行業在國家政策引導及地方產業配套支持下已形成高速增長態勢，良好的行業前景吸引了更多的市場新進入者以及資本力量的匯聚，共同推動了行業的繁榮。然而，伴隨產能規模化釋放，市場供給不斷增加，行業競爭進一步加劇。儘管本公司通過自主研發，在工藝迭代、新產品開發方面取得了不錯的進展，並構建了較為完整的技術儲備與量產經驗體系，但在核心技術壁壘構建、高端市場滲透能力等方面仍與行業龍頭企業存在一定差距。未來，倘若行業產能供應過剩、競爭對手推出新技術、公司不能準確把握市場需求變化趨勢以及時調整競爭策略，可能導致公司產品定價承壓、市場份額下滑，從而對公司的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

3. 供應鏈風險

集成電路行業對核心原材料、精密零部件、專用軟件及高端設備的品質與適配性具有嚴苛標準，是保證公司穩定生產的必要條件，但部分重要原材料、零部件、專用軟件、核心設備等的全球合格供應商數量較少，部分供應商可能位於地緣政治不穩定的地區。儘管公司持續強化供應鏈安全體系建設，積極推動關鍵設備及材料的國產化替代，以降低對外部供應的依賴，但國際貿易環境不確定性的影響依然存在。若因地緣政治等其他不可抗力的因素，導致公司的重要材料、零備件、軟件、設備等的出口許可、物流受到限制或成本上漲，將對公司產能規劃實施效率、技術迭代進度、客戶關係維繫帶來潛在不利影響，從而影響公司的整體運營和發展。

(五) 宏觀環境風險

1. 國際貿易摩擦加劇的風險

在全球經濟一體化的大環境下，國家之間的經濟往來與政治互動緊密相關，國際形勢的變動直接影響著國際貿易的格局，也對特定產業的發展產生深遠影響。近年來，國際貿易摩擦不斷，集成電路產業成為貿易衝突的重點領域，部分國家採用提高關稅、出口管制、技術限制等非市場化干預措施，客觀上制約我國產業鏈生態協同發展進程。儘管公司在經營過程中始終遵守中國及境外法律法規，並積極構建多元化供應鏈與市場佈局以規避單一區域風險，但國際環境的複雜性和多變性意味著，國際貿易政策可能突然發生不利變更，將對公司的業務拓展和供應鏈管理帶來限制，進而影響公司的正常運營。

2. 宏觀經濟波動和行業週期性風險

公司主要從事集成電路相關產品研發、生產及銷售，屬於集成電路行業的中游環節。半導體行業具備顯著的週期性，整體經營業績與宏觀環境、下游終端產業景氣度高度綁定。若未來宏觀經濟形勢發生重大變化，下游終端產業需求低迷，將導致IC設計公司新產品發佈延遲、下游廠商備貨策略趨於謹慎或施加更大的定價壓力，包括公司在內的集成電路企業將面臨一定的行業波動風險，對經營情況造成不利影響。

五、報告期內主要經營情況

報告期內，我們實現收入人民幣5,765,812千元，較上年同期的人民幣5,129,794千元增長12.40%；本公司擁有人應佔期內利潤為人民幣245,373千元，較上年同期的人民幣332,129千元下降26.12%；經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2,797,992千元，較上年同期的人民幣1,705,036千元增長64.10%。

(一) 主營業務分析

1、財務報表相關科目變動分析表

單位：人民幣千元

科目	本報告期 (未經審計)	上年同期 (未經審計)	變動比例(%)
收入	5,765,812	5,129,794	12.40
銷售成本	(4,532,968)	(3,869,945)	17.13
毛利	1,232,844	1,259,849	-2.14
其他收入	144,184	85,697	68.25
銷售開支	(44,088)	(28,172)	56.50
一般及行政開支	(260,237)	(206,235)	26.18
融資成本	(306,919)	(150,833)	103.48
研發開支	(609,227)	(694,820)	-12.32
期內利潤	221,521	232,000	-4.52
經營活動產生的現金流量淨額	2,797,992	1,705,036	64.10
投資活動所用的現金流量淨額	(3,919,312)	(4,800,082)	-18.35
籌資活動產生的現金流量淨額	3,548,362	371,378	855.46

(1) 收入

於報告期內，本集團取得收入人民幣5,765,812千元，較上年同期的人民幣5,129,794千元增加12.40%，主要由於報告期內我們的產品銷量增加，收入規模持續增長。

按業務線劃分的收入：

單位：人民幣千元

	本報告期 (未經審計)	佔比(%)	上年同期 (未經審計)	佔比(%)
集成電路晶圓代工	5,765,812	100.00	5,105,041	99.52
DDIC	3,069,686	53.24	3,109,391	60.61
CIS	1,461,216	25.34	1,052,247	20.51
PMIC	739,385	12.82	619,383	12.07
其他集成電路	495,525	8.60	324,020	6.33
其他	-	-	24,753	0.48
合計	<u>5,765,812</u>	<u>100.00</u>	<u>5,129,794</u>	<u>100.00</u>

按地區劃分的收入：

單位：人民幣千元

	本報告期 (未經審計)	上年同期 (未經審計)
中國大陸	3,653,755	3,059,823
中國台灣	1,548,471	1,647,968
其他國家／地區	<u>563,586</u>	<u>422,003</u>
合計	<u>5,765,812</u>	<u>5,129,794</u>

(2) 銷售成本

於報告期內，本集團的銷售成本為人民幣4,532,968千元，較上年同期的人民幣3,869,945千元增加17.13%，主要由於產品銷售規模擴大，投入增加以及受物業、廠房及設備轉固影響，相關折舊費用增加。

(3) 毛利及毛利率

於報告期內，本集團的毛利為人民幣1,232,844千元，較上年同期的人民幣1,259,849千元減少2.14%；毛利率為21.38%，較上年同期的24.56%減少3.18個百分點，主要由於市場競爭加劇，產品價格有所波動，受生產週期影響，部分產品價格上調帶來的積極影響尚未在當期業績中充分體現，疊加物業、廠房及設備折舊增加，導致毛利及毛利率短期有所下滑。

(4) 其他收入

於報告期內，本集團的其他收入為人民幣144,184千元，較上年同期的人民幣85,697千元增加68.25%，主要由於本期遞延政府補助滿足結轉確認其他收入條件，轉入其他收入。

(5) 銷售開支

於報告期內，本集團的銷售開支為人民幣44,088千元，較上年同期的人民幣28,172千元增加56.50%，主要由於(i)股份支付開支較上年同期有所上升；(ii)為加快新產品導入和推動後續深入合作相關費用增加。

(6) 一般及行政開支

於報告期內，本集團的一般及行政開支為人民幣260,237千元，較上年同期的人民幣206,235千元增加26.18%，主要由於物業、廠房及設備折舊及股份支付開支上升。

(7) 融資成本

於報告期內，本集團的融資成本為人民幣306,919千元，較上年同期的人民幣150,833千元增加103.48%，主要由於上年同期收到財政貼息及部分借款利息資本化導致借款利息淨額較本報告期減少。

(8) 研發開支

於報告期內，本集團的研發開支為人民幣609,227千元，較上年同期的人民幣694,820千元減少12.32%，主要由於符合資本化條件的研發項目進入開發階段，本集團將相關研發開支予以資本化。

(9) 期內利潤

於報告期內，本集團的期內利潤為人民幣221,521千元，較上年同期的人民幣232,000千元減少4.52%，主要由於(i)市場競爭加劇，產品價格有所波動，受生產週期影響，部分產品價格上調帶來的積極影響尚未在當期業績中充分體現，疊加物業、廠房及設備折舊增加，導致毛利率短期有所下滑；(ii)受上年同期收到財政貼息影響，報告期內融資成本較上年同期增加；(iii)股份支付開支較上年同期有所上升。

(10) 現金流量

於報告期內，本集團經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2,797,992千元。經營活動現金流量淨額與稅前利潤人民幣235,601千元存在差額，主要由以下兩方面因素形成：(i)非現金、非經營性項目調整，主要為物業、廠房及設備折舊人民幣2,078,870千元、無形資產攤銷人民幣180,151千元；(ii)營運資本變動，主要包括存貨減少人民幣191,425千元、貿易及其他應付款項增加人民幣126,595千元；上述影響部分被貿易應收款項增加人民幣106,278千元、合同負債減少人民幣104,779千元所抵銷。

於報告期內，本集團投資活動現金流出淨額為人民幣3,919,312千元，主要事項如下：(i)購置物業、廠房及設備，支出人民幣3,667,604千元；(ii)購置無形資產，支出人民幣296,635千元；(iii)購入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，支出人民幣2,468,183千元；(iv)處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，收回現金人民幣2,369,197千元；(v)處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，收回現金人民幣143,360千元。

於報告期內，本集團籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣3,548,362千元，主要構成如下：(i)取得借款收到現金人民幣3,218,703千元；(ii)償還借款支付現金人民幣864,835千元；(iii)子公司少數股東投入資本金人民幣1,600,000千元；(iv)支付借款及應付債券利息人民幣292,874千元。

2、流動資金與資本來源

(1) 資產負債比率

於2026年6月30日，本集團的資產負債比率(定義為負債總額除以資產總額之比率)為47.05%(於2025年12月31日：47.30%)，整體變動幅度較小。

下表載列本集團於2026年6月30日及2025年12月31日的資產總額及負債總額之絕對金額以及資產負債比率：

單位：人民幣千元

	於2026年 6月30日 (未經審計)	於2025年 12月31日
資產總額	58,782,603	53,297,969
負債總額	27,656,312	25,210,280
資產負債比率	<u>47.05%</u>	<u>47.30%</u>

(2) 現金流變動情況

報告期內現金流量表項目的變動分析請參閱本節「五、(一) 1.財務報表相關科目變動分析表」。

(3) 借款

於2026年6月30日，本集團的未償還借款為人民幣21,846,308千元（於2025年12月31日：人民幣19,492,681千元），其中人民幣2,070,397千元須於一年內償還（於2025年12月31日：人民幣1,972,941千元）。於2026年6月30日及2025年12月31日，借款的實際年利率介於1.50%至6.18%。

(4) 資本開支及資金來源

資本開支包括購買物業、廠房及設備項目付款、購買無形資產項目付款以及使用權資產預付款。於2026年1-6月，我們的資本開支由2025年1-6月的人民幣4,142,080千元下降4.29%至人民幣3,964,239千元，主要由於支付的購置設備款減少所致。

我們過往主要以經營活動產生的現金、債務及股權融資為現金需求提供資金。我們監測及維持充足的現金及現金等價物水平，以為運營提供資金，並降低現金流量波動的影響。於2026年6月30日，我們的現金及現金等價物餘額由2025年12月31日的人民幣2,276,620千元增加105.60%至人民幣4,680,698千元，主要是由於借款增加及子公司皖芯集成少數股東增資。展望未來，我們相信，我們的流動資金需求將通過使用經營現金流量、股本及債務融資以及H股全球發售估計所得款項淨額組合滿足。

3、財務風險管理

(1) 外匯風險

本集團承受的匯率風險主要與以美元、日元、港元計價的現金及現金等價物、貿易應收款項、貿易及其他應付款項、借款等有關，除設立在中華人民共和國香港特別行政區和日本下屬子公司以及部分銀行賬戶、客戶和供應商使用港幣、日元、美元、歐元等計價結算外，本集團的其他主要業務以人民幣計價結算。

我們密切關注匯率變動對本集團匯率風險的影響。我們持續監控本集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險。本集團於報告期內並無使用任何衍生工具合約對沖其貨幣風險。

(2) 利率風險

我們的利率風險主要產生於長期浮動利息借款、應付債券等長期帶息債務。我們根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。

我們的財務部門持續監控集團利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本集團尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本集團的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整。

(3) 價格風險

我們面臨的股權價格風險主要來自所持分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益或以公允價值計量且其變動計入當期損益的上市權益工具。為管理上市權益工具所產生的價格風險，我們分散其投資組合。該等投資基於持有目的而作出。我們的管理層按個別基準對各項投資進行管理。

(4) 信用風險

本集團所面臨的最大信用風險在於按攤餘成本計量的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據的賬面價值。本集團並無持有任何抵押品或其他信用加強措施，以覆蓋其金融資產的相關信用風險。

(5) 流動性風險

本集團旨在維持充足的現金及現金等價物。由於相關業務的多變性，我們通過維持足夠的現金及現金等價物餘額，以維持資金靈活性。

(二) 資產、負債情況分析

1、 資產及負債狀況

單位：人民幣千元

項目名稱	本報告 期末 (未經審計)	本報告 期末佔 總資產的 比例(%)	上年度末	上年度末 佔總資產 的比例(%)	變動比例 (%)	情況說明
現金及現金等價物	4,680,698	7.96	2,276,620	4.27	105.60	借款增加以及取得子公司皖芯集成少數股東增資款
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產—非流動部分	1,555,507	2.65	501,964	0.94	209.88	對外投資增加及公允價值變動增加
合同負債	211,874	0.36	316,652	0.59	-33.09	持續履行合同責任並結轉確認相應收入
遞延收入	749,698	1.28	427,633	0.80	75.31	取得與資產相關的政府補助增加
遞延稅項負債	12,666	0.02	-	-	不適用	子公司對外以公允價值計量且其變動計入當期損益的股權投資持有期間公允價值變動產生的應納稅暫時性差異增加
應付債券—流動部分	30,408	0.05	16,256	0.03	87.06	計提的應付債券利息增加

2、 質押／抵押資產

(1) 作為抵押品的資產

於本報告期末，因合肥建投為本公司融資授信提供連帶責任保證擔保，擔保本金餘額為人民幣3,000,000千元，本公司就合肥建投提供的保證擔保向合肥建投提供動產抵押反擔保，截至報告期末，已辦理抵押登記的機器設備的賬面價值為人民幣3,995,232千元。

(2) 用途受限的資金

於本報告期末，用途受限的資金包括為擔保借款而尚未解質押的銀行存款人民幣108,569千元。

3、 或有負債

於2026年6月30日，本集團並無任何重大或有負債。

(三) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

單位：人民幣千元

本報告期投資額	上年同期 投資額	變動幅度
<u>3,358,635</u>	<u>100,000</u>	<u>3,258.63%</u>

附註：報告期對外股權投資事項包括向合肥瑞昱、晶奕集成、晶合集成香港、合肥晶為出資。不包括證券投資情況。

2、 重大的股權投資

單位：人民幣千元

被投資 公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額	持股比例	資金來源	截至	本期投資 損益	披露日期及 索引(如有)
						報告期末 進展情況		
晶奕集成	集成電路芯片及 產品製造、銷 售、設計及服 務，電子專用材 料研發、新材料 技術研發	股權受讓 及增資	2,000,000	100.00%	自有及 自籌資金	已完成	/	2026年2月7日在上海 證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披 露的《晶奕集成關 於擬對外投資的公 告》(2026-002)
合計	/	/	<u>2,000,000</u>	/	/	/	/	/

3、 重大的非股權投資

無

4、 以公允價值計量的金融資產

單位：人民幣千元

資產類別	期 初 數	期 末 數
以公允價值計量且其變動 計入損益的金融資產	1,766,634	1,897,963
以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的金融資產	<u>508,027</u>	<u>1,555,507</u>
合計	<u>2,274,661</u>	<u>3,453,470</u>

證券投資情況

單位：人民幣千元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初 投資成本	資金來源	報告期初 賬面價值	報告期末 賬面價值	會計核算科目
境內外股票	688213	思特威	23,757	自有或自籌	71,335	80,324	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產
境內外股票	688593	新相微	46,394	自有或自籌	83,741	-	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產
境內外股票	688729	屹唐股份	30,000	自有或自籌	86,911	152,663	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產
境內外股票	688783	西安奕材	94,160	自有或自籌	259,977	676,376	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產
境內外股票	688797	臻寶科技	41,721	自有或自籌	-	646,144	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產
境內外股票	09973	奇瑞汽車	292,018	自有或自籌	289,498	197,613	以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
境內外股票	03296	華勤技術	173,459	自有或自籌	-	209,574	以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
境內外股票	09630	芯碁微裝	55,031	自有或自籌	-	111,986	以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
境內外股票	03661	聖邦股份	48,155	自有或自籌	-	67,862	以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
合計	/	/	<u>804,695</u>	/	<u>791,462</u>	<u>2,142,542</u>	/

衍生品投資情況

無

5、 私募股權投資基金投資情況

單位：人民幣千元

私募基金名稱	投資協議		擬投資 總額	報告期內 投資金額	截至	參與身份	報告期末	是否控制	會計	是否存在	基金底層	報告期	累計
	簽署時點	投資目的			已投資		出資比例	該基金或					
					金額		(%)	影響	核算科目	關聯關係	資產情況	利潤影響	利潤影響
晶匯聚芯	2023年11月	尋求企業的中 長期產業價值	200,000	-	200,000	有限合夥人	43.96	是	投資聯營 企業	否	產業投資	(1,869)	(4,905)
晶匯創芯	2025年6月	尋求企業的中 長期產業價值	200,000	-	100,000	有限合夥人	44.35	是	投資聯營 企業	否	產業投資	701	(317)
合計	/	/	400,000	-	300,000	/	/	/	/	/	/	(1,168)	(5,222)

(四) 重大資產和股權出售

無

(五) 主要控股參股公司分析

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：人民幣千元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	收入	除所得稅前 (虧損)/利潤	期內 (虧損)/利潤
新品集成	子公司	集成電路芯片及產品製造； 集成電路芯片及產品銷售	7,688,903	15,340,356	10,159,893	814,252	(333,354)	(333,354)
晶合日本	子公司	為集成電路設計支持服務及 技術開發支持	3.5億日元	4,859	4,649	5,674	522	466
皖芯集成	子公司	集成電路芯片及產品製造、 銷售、設計及服務，電子專用 材料研發、新材料技術研發	12,428,925	24,228,821	11,831,604	2,092,054	(36,010)	(35,979)
晶合集成香港	子公司	集成電路相關產品、配套產品 研發、生產及銷售	200,000	409,039	264,337	-	79,190	66,268

報告期內取得和處置子公司的情況

公司名稱	報告期內取得和 處置子公司方式	對整體生產經營和 業績的影響
晶奕集成	股權受讓及增資	對整體生產經營及業績無 重大影響
晶合集成香港	新設成立	對整體生產經營及業績無 重大影響
合肥晶為	新設成立	對整體生產經營及業績無 重大影響
合肥瑞昱	新設成立	對整體生產經營及業績無 重大影響

(六) 公司控制的結構化主體情況

本集團納入合併範圍的結構化主體包括Aurora SF，為一家新加坡可變資本公司，亦為EasternGate Investments VCC的子基金。由於本集團對此類結構化主體擁有權力，通過參與相關活動享有可變回報，並且有能力運用被投資方的權力影響其可變回報，因此本集團對此類結構化主體存在控制。

六、其他披露事項

(一) 僱員、薪酬政策及培訓情況

於2026年6月30日，本集團共有5,738名僱員。截至2026年6月30日止六個月的僱員福利開支總額(包括以股份為基礎支付的報酬)為人民幣963,293千元，而截至2025年6月30日止六個月為人民幣807,055千元。薪酬總額增加主要由於：(i)公司人數隨業務增長而增加；(ii)2025年新授予限制性股票，股份支付開支增加。

我們為僱員提供各種激勵及福利。我們向僱員(特別是主要僱員)提供具有競爭力的薪金、獎金及以股份為基礎支付的報酬。我們已根據適用法律為僱員繳納社會保險(包括養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等)及住房公積金，在此基礎上，為進一步完善僱員福利保障體系，我們額外為僱員建立了補充醫療保險和企業年金等。為表彰關鍵僱員的貢獻、激勵管理團隊及促進長遠可持續發展，我們已採納限制性股票激勵計劃。

為維持僱員的素質、知識及技能水平，本集團為僱員提供持續的教育及培訓計劃，包括內部及外部培訓，以強化他們的技術、專業或管理技能。本集團亦不時為僱員提供培訓計劃，以確保他們在各個方面均了解並遵守我們的政策及程序。

期後事件

2026年7月10日，本公司H股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，本公司根據H股全球發售按每股H股32.30港元發行合共216,167,000股H股。

於2026年8月6日，超額配股權獲部分行使，涉及合共10,886,900股H股。該等H股於2026年8月11日根據部分行使超額配股權發行及配發。

中期股息

董事會已決議不就截至2026年6月30日止六個月宣派任何中期股息(截至2025年6月30日止六個月：無)。

其他資料

1. 遵守《企業管治守則》

本公司致力維持高水平的企業管治，以保障股東權益和提升企業價值及問責性。由於本公司H股於報告期內尚未於聯交所上市，《香港上市規則》附錄C1《企業管治守則》於報告期內並不適用於本公司。自上市日期起至本公告日期，本公司已遵守《企業管治守則》第二部分所載所有適用守則條文。

2. 遵守《標準守則》

由於本公司H股於報告期內尚未於聯交所上市，《標準守則》於報告期內並不適用。本公司自上市日期起已採納《標準守則》。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認自上市日期起至本公告日期一直遵守《標準守則》所載標準。

3. 購買、出售或贖回公司上市證券

由於本公司於報告期間尚未在聯交所上市，故披露有關本公司或其任何附屬公司購買、出售或贖回本公司上市證券的詳情於報告期間並不適用於本公司。自上市日期以來及直至本公告日期，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司於聯交所上市的任何證券(包括出售庫存股份)。

4. 審計委員會審閱

本集團截至2026年6月30日止六個月的簡明合併中期財務報表(「中期財務資料」)已由本公司根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製。中期財務資料未經外部審計師審核與審閱，惟已由本公司審計委員會審閱。審計委員會已審閱本集團於報告期內的未經審核簡明合併中期財務報表，並認為該等財務資料乃根據適用會計準則、規則及法規編製以及已作出適當披露。

刊發中期業績及中期報告

本中期業績公告刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk、上海證券交易所網站www.sse.com.cn及本公司網站<https://www.nexchip.com.cn/>。本公司截至2026年6月30日止六個月之中期報告將於適當時候在上述聯交所及本公司網站刊載。

致謝

董事會謹此衷心感謝所有客戶、供應商及所有股東的理解、支持和信任，本公司全體員工將繼續長期齊心協力勤奮工作。

釋義

晶合集成、公司、本公司	指	合肥晶合集成電路股份有限公司
本集團、我們、我們的	指	合肥晶合集成電路股份有限公司及其附屬公司
華勤技術	指	華勤技術股份有限公司
思特威	指	思特威(上海)電子科技股份有限公司
新相微	指	上海新相微電子股份有限公司
屹唐股份	指	北京屹唐半導體科技股份有限公司
西安奕材	指	西安奕斯偉材料科技股份有限公司
臻寶科技	指	重慶臻寶科技股份有限公司
奇瑞汽車	指	奇瑞汽車股份有限公司
聖邦股份	指	聖邦微電子(北京)股份有限公司
芯碁微裝	指	合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
晶合日本	指	晶合日本株式會社
晶合集成香港	指	晶合集成香港有限公司
新晶集成	指	合肥新晶集成電路有限公司
皖芯集成	指	合肥皖芯集成電路有限公司
晶奕集成	指	合肥晶奕集成電路有限公司
晶匯聚芯	指	合肥晶匯聚芯投資基金合夥企業(有限合夥)
晶匯創芯	指	六安晶匯創芯股權投資基金合夥企業(有限合夥)
合肥晶為	指	合肥晶為科技有限公司
合肥瑞昱	指	合肥瑞昱科技有限公司

A股	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境內上市內資股，於上海證券交易所科創板上市並以人民幣認購及買賣
H股	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市並以港元認購及買賣
報告期、本期、 本報告期	指	2026年1月1日至2026年6月30日
報告期末、本報告期末	指	2026年6月30日
上年同期	指	2025年1月1日至2025年6月30日
上年度末	指	2025年12月31日
元、千元、百萬元、 億元	指	人民幣元、千元、百萬元、億元
股東會	指	合肥晶合集成電路股份有限公司股東會
董事會	指	合肥晶合集成電路股份有限公司董事會
晶圓	指	製造半導體芯片的襯底(也叫基片)。由於是圓形晶體材料，所以稱為晶圓。按照直徑進行分類，主要包括4英寸、5英寸、6英寸、8英寸、12英寸等規格
DDIC	指	Display Driver IC，顯示驅動芯片
CIS	指	CMOS Image Sensor，CMOS圖像傳感器
PMIC	指	Power Management IC，電源管理芯片
MCU	指	Microcontroller Unit，微控制單元
MOSFET	指	金屬氧化物半導體場效應晶體管，是一種可以廣泛使用在模擬電路與數字電路的場效晶體管
Logic	指	Logic IC，邏輯芯片

E-tag	指	electronic tag，電子標籤
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶顯示屏
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有機發光二極管
CMOS	指	互補金屬氧化物半導體
BCD	指	一種結合了雙極型、CMOS和DMOS的單片IC製造工藝
SRAM	指	Static Random-Access Memory，靜態隨機存取存儲器
SoC	指	System on Chip，系統級芯片
FPGA	指	Field Programmable Gate Array，現場可編程門陣列
CPU	指	Central Processing Unit，中央處理器
H股全球發售	指	香港公開發售及國際發售(兩者定義見H股招股章程)
製程	指	集成電路製造過程中，以晶體管最小線寬尺寸為代表的技術工藝，尺寸越小，工藝水平越高，意味著在同樣面積的晶圓上，可以製造出更多的芯片，或者同樣晶體管規模的芯片會佔用更小的空間
nm	指	納米，長度的度量單位，1nm等於10的負9次方米
限制性股票激勵計劃	指	本公司分別於2023年8月31日及2025年5月28日獲股東批准的兩項限制性股票激勵計劃

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
 執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年8月24日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、藺智挺教授及陳鋌先生。